

深圳市深科达智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的
第二轮审核问询函中有关财务事项的回复

大华核字[2022]003307号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市深科达智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的
第二轮审核问询函中有关财务事项的回复

目 录

页 次

一、	向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函中有关财务事项的回复	1-51
----	--	------

深圳市深科达智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的
第二轮审核问询函中有关财务事项的回复

大华核字[2022]003307 号

上海证券交易所：

由安信证券股份有限公司转来的《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）（2022）35号）奉悉。我们已对审核问询函所提及的和深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“深科达”或“发行人”）财务事项进行了审慎核查，现回复如下：

1.关于融资规模

根据申报材料，1）本次募集资金拟投入惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目11,766.50万元，半导体先进封装测试设备研发及生产项目8,925.59万元，平板显示器件自动化专用设备生产建设项目5,307.91万元。2）直接补充流动资金10,000.00万元。

请发行人说明：（1）上述各项目投资金额的具体构成，测算依据及测算过程，是否合理；（2）根据投资构成中非资本性支出的情况及《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第4问，补充流动资金比例是否超过募集资金总额的30%。

请申报会计师核查并发表意见。

回复：

一、上述各项目投资金额的具体构成，测算依据及测算过程，是否合理

（一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目

本项目拟投资 15,504.83 万元，其中拟使用募集资金投资 11,766.50 万元，具体资金投入情况如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)	是否为资本性支出
1	场地投资	5,318.14	5,318.14	是
2	设备及软件投资	6,448.36	6,448.36	是
3	预备费	738.33	-	否
4	铺底流动资金	3,000.00	-	否
合计		15,504.83	11,766.50	/

惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目的投资金额具体构成、测算依据及测算过程如下：

1、场地投资

本项目场地投资主要为募投产品生产车间的建设及装修，场地总建筑面积为13,295.36平方米，场地投资总额为5,318.14万元，其中建设投资金额为2,393.16万元，装修费投资为2,924.98万元。场地总建筑面积主要是在现有可使用土地的基础上根据募投项目生产实际需要确定的；生产车间主要为钢结构和砖混结构，参考现有厂房的标准建设和装修，价格主要根据募投项目实施地当前物价水平确定，具体投资情况如下：

序号	项目	建筑面积 (m ²)	建设投资 (万元)	装修费 (万元)	单位造价 (元/m ²)
1	机加车间	4,000.00	720.00	680.00	3,500.00
2	装配车间	3,720.22	669.64	632.44	3,500.00
3	无尘调试车间	3,000.00	540.00	840.00	4,600.00
4	研发试验场地	2,575.14	463.53	772.54	4,800.00
合计		13,295.36	2,393.16	2,924.98	4,000.00

本次募投项目实施地点为惠州市，根据公开资料显示，其他上市公司在惠州市新建项目场所造价的具体情况如下：

公司名称	项目名称	场地投资金额 (万元)	建筑面积 (m ²)	单位造价 (元/m ²)
诺德股份	惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目	14,202.00	39,358.00	3,608.42
硕贝德	5G 散热组件建设项目（新建制造楼）	4,464.24	11,748.00	3,800.00
杰普特	半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目	2,891.00	7,000.00	4,130.00
	半导体激光器扩产建设项目	2,050.00	5,000.00	4,100.00

由上可以看出，公司本次募投项目单位造价与其他上市公司披露的惠州地区募投项目自建场所的单位造价不存在较大差异，具有合理性。

2、设备及软件投资

本项目涉及的产品主要为针对 Mini/Micro-LED 显示屏幕的智能组装及检测设备。为提高募投产品的研发水平及自主生产能力，进一步提升公司的产品交期管控和质量控制水平，本项目将引进自动化程度更高、更先进的生产设备及配套软件。在综合考虑项目的产品特点、产品负荷、产品质量检测、生产工艺流程设计以及综合管理等实际情况需要的基础上，合理估算项目所需具体设备及软件投资金额为 6,448.36 万元，其中生产设备投资 4,887.36 万元，研发设备投资 502.50 万元，管理及办公设备投资 450.00 万元，软件投资 608.50 万元。设备及软件的数量系主要基于项目预计需求而确定，设备及软件的价格主要参照相同或类似规格/型号设备及软件的市场价格测算得出。设备及软件投资的具体明细如下：

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	切管机	生产设备	P6018D-H3000	台	165.00	1	165.00
2	切割机	生产设备	G4020PRO	台	76.00	1	76.00
3	切割机	生产设备	G6025F	台	148.00	1	148.00
4	折弯机	生产设备	1003	台	33.80	1	33.80
5	折弯机	生产设备	1254	台	38.80	1	38.80
6	折弯机	生产设备	5013	台	25.80	1	25.80
7	龙门加工中心	生产设备	BF-6036L	台	280.00	2	560.00
8	龙门加工中心	生产设备	BF-8032L	台	290.00	1	290.00
9	焊接平台	生产设备	6米×3米	台	4.00	4	16.00
10	焊接平台	生产设备	4米×2米	台	3.60	4	14.40
11	焊接平台	生产设备	8米×4米	台	8.50	1	8.50
12	龙门铣	生产设备	GMC3080GRV	台	228.00	2	456.00
13	龙门铣	生产设备	GMC2040GRV	台	112.00	2	224.00
14	铣边龙门铣	生产设备	CX6020	台	89.80	1	89.80
15	加工中心	生产设备	BF-V6	台	26.00	8	208.00
16	加工中心	生产设备	BF-V8	台	28.00	12	336.00
17	加工中心	生产设备	BF-2013	台	75.00	5	375.00
18	加工中心	生产设备	BF-3025	台	120.00	4	480.00
19	磨床	生产设备	105SA1	台	89.00	1	89.00
20	手摇磨床	生产设备	ACC450ST	台	12.00	1	12.00
21	手摇磨床	生产设备	HF-618S	台	4.10	4	16.40
22	普通车床	生产设备	CA6140B/A/1500	台	6.70	2	13.40
23	数控车床	生产设备	CAK50135	台	13.00	4	52.00
24	摇臂钻床	生产设备	Z3050×16/1	台	7.98	2	15.96

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
25	镗床	生产设备	BMC-110R2	台	270.00	2	540.00
26	五面体加工中心	生产设备	ML-540Z2	台	408.00	1	408.00
27	钻攻机	生产设备	ZQS4116/I	台	0.40	5	2.00
28	线切割	生产设备	CDK63	台	6.10	10	61.00
29	普铣	生产设备	X63254#炮塔铣	台	3.10	15	46.50
30	车铣复合加工中心	生产设备	GLS-3300/LM	台	86.00	1	86.00
31	同步双频感应核心关键元部件 ELDEC	研发设备	/	台	80.00	1	80.00
32	红外测温系统	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
33	专用淬火矫直机床系统	研发设备	/	台	80.00	1	80.00
34	专用淬火冷却系统	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
35	淬火液净化环保系统	研发设备	/	台	50.00	1	50.00
36	16m 恒温平台检测室	研发设备	/	台	25.00	1	25.00
37	高速相机	研发设备	/	台	2.50	5	12.50
38	CameraLink 数据采集卡	研发设备	/	个	0.22	5	1.10
39	远心镜头	研发设备	/	个	0.11	4	0.44
40	同轴光源	研发设备	/	个	0.62	4	2.48
41	光源控制器	研发设备	/	个	0.25	1	0.25
42	激光位移传感器	研发设备	/	个	9.68	4	38.72
43	激光跟踪仪	研发设备	/	台	99.70	1	99.70
44	工控机	研发设备	/	台	0.71	1	0.71
45	激光干涉系统	研发设备	/	台	32.00	1	32.00
46	激光尺系统	研发设备	/	台	28.00	1	28.00
47	伺服电机及其组件	研发设备	/	台	1.50	4	6.00
48	伺服装置	研发设备	/	套	1.40	4	5.60
49	服务器+存储	管理及办公设备	/	套	80.00	1	80.00
50	网络+无线	管理及办公设备	/	套	70.00	1	70.00
51	办公电脑	管理及办公设备	/	台	0.80	100	80.00
52	广播系统	管理及办公设备	/	台	30.00	1	30.00
53	打印复印一体机	管理及办公设备	/	台	2.00	15	30.00
54	投影仪	管理及办公设备	/	台	1.00	5	5.00
55	会议系统	管理及办公设备	/	套	1.50	10	15.00
56	监控系统	管理及办公设备	/	套	50.00	1	50.00
57	门禁系统	管理及办公设备	/	套	20.00	1	20.00
58	考勤系统	管理及办公设备	/	套	25.00	2	50.00
59	防疫系统	管理及办公设备	/	套	20.00	1	20.00
60	ERP 管理系统	软件	/	套	150.00	1	150.00

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
61	PLM 产品数据管理系统	软件	/	套	80.00	1	80.00
62	PMS 项目管理系统	软件	/	套	25.00	1	25.00
63	SRM 供应商管理系统	软件	/	套	10.00	1	10.00
64	业务流程管理系统	软件	/	套	50.00	1	50.00
65	文件加密系统	软件	/	套	30.00	1	30.00
66	资料防泄密系统	软件	/	套	20.00	1	20.00
67	企业防病毒系统	软件	/	套	25.00	1	25.00
68	资料库 ORACLE	软件	/	套	46.00	2	92.00
69	微软系统软件 Winpro	软件	/	套	0.50	100	50.00
70	微软系统软件 OfficeStd	软件	/	套	0.32	100	32.00
71	微软系统软件 WinSvrSTD	软件	/	套	0.80	10	8.00
72	微软系统软件 SQLSvrSTD	软件	/	套	6.00	5	30.00
73	流程图软件	软件	/	套	0.10	50	5.00
74	PDF 编辑软件	软件	/	套	0.05	30	1.50
合计							6,448.36

3、预备费

根据项目生产经营情况，在对整个项目所需流动资金进行合理预算的前提下，本项目拟计划投入预备费，用于项目实施期间由于价格、设计变更等原因引起工程造价变化的开支；本项目的预备费为 738.33 万元，不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。

4、铺底流动资金

本项目铺底流动资金为 3,000 万元，主要综合考虑未来项目应收账款、存货、货币资金等经营性流动资产以及应付账款等经营性流动负债的情况对流动资金的需求等因素的影响而设置，系项目运营早期为保证项目正常运转所必须的流动资金，不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。

由上可知，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目投资总额为 15,504.83 万元，包含场地投资 5,318.14 万元、设备及软件投资 6,448.36 万元、预备费 738.33 万元和铺底流动资金 3,000.00 万元，上述各项投资是在充分考虑项目实际规划所需、项目建设及运营情况、项目不确定支出和保障项目顺利实施等因素的基础上测算得出；其中场地投资、设备及软件投资拟使用本次募集资金，共

计 11,766.50 万元；预备费、铺底流动资金不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。因而，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目投资金额的具体构成清晰明确，测算依据及测算过程具有合理性。

(二) 半导体先进封装测试设备研发及生产项目

本项目拟投资 12,521.87 万元，其中拟使用募集资金投资 8,925.59 万元，具体资金投入情况如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)	是否为资本性支出
1	场地投资	3,545.43	3,545.43	是
2	设备及软件投资	5,380.16	5,380.16	是
3	预备费	596.28	-	否
4	铺底流动资金	3,000.00	-	否
	合计	12,521.87	8,925.59	/

半导体先进封装测试设备研发及生产项目的投资金额具体构成、测算依据及测算过程如下：

1、场地投资

本项目场地投资主要为募投产品生产车间的建设及装修，场地总建筑面积为 8,863.57 平方米，场地投资总额为 3,545.43 万元，其中建设投资金额为 1,595.44 万元，装修费投资为 1,949.99 万元。场地总建筑面积主要是在现有可使用土地的基础上根据募投项目生产实际需要确定的；生产车间主要为钢结构和砖混结构，参考现有厂房的标准建设和装修，价格主要根据募投项目实施地当前物价水平确定具体投资情况如下：

序号	项目	建筑面积 (m ²)	建设投资 (万元)	装修费 (万元)	单位造价 (元/m ²)
1	机加车间	3,000.00	540.00	510.00	3,500.00
2	装配车间	2,116.04	380.89	359.73	3,500.00
3	无尘调试车间	2,200.00	396.00	616.00	4,600.00
4	研发试验场地	1,547.53	278.56	464.26	4,800.00
	合计	8,863.57	1,595.44	1,949.99	4,000.00

本次募投项目实施地点为惠州市，根据公开资料显示，其他上市公司在惠州市新建项目场所造价的具体情况参见本回复“1.关于融资规模”之“一、上述各项目投资金额的具体构成，测算依据及测算过程，是否合理”之“（一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”之“1、场地投资”的统计表格。

由上可以看出，公司本次募投项目单位造价与其他上市公司披露的惠州地区募投项目自建场所的单位造价不存在较大差异，具有合理性。

2、设备及软件投资

本项目涉及的产品主要为半导体先进封装及测试设备。为提高募投产品的自主研发能力，进一步提升公司的产品交期管控和生产质量控制水平，本项目将引进自动化程度更高、更先进的生产设备、研发设备及配套软件。在综合考虑项目的产品特点、产品负荷、产品质量检测、生产工艺流程设计以及综合管理等实际情况需要的基础上，合理估算项目所需具体设备及软件投资金额为5,380.16万元，其中生产设备投资4,502.46万元，研发设备投资515.20万元，软件投资362.50万元。设备及软件的数量系主要基于项目预计需求而确定，设备及软件的价格主要参照相同或类似规格/型号设备及软件的市场价格测算得出。设备及软件投资的具体明细如下：

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	切管机	生产设备	P6018D-H3000	台	165.00	1	165.00
2	切割机	生产设备	G4020PRO	台	76.00	1	76.00
3	切割机	生产设备	G6025F	台	148.00	1	148.00
4	折弯机	生产设备	1003	台	33.80	1	33.80
5	折弯机	生产设备	1254	台	38.80	1	38.80
6	折弯机	生产设备	5013	台	25.80	1	25.80
7	龙门加工中心	生产设备	BF-6036L	台	280.00	2	560.00
8	龙门加工中心	生产设备	BF-8032L	台	290.00	1	290.00
9	焊接平台	生产设备	6米×3米	台	4.00	4	16.00
10	焊接平台	生产设备	4米×2米	台	3.60	4	14.40
11	焊接平台	生产设备	8米×4米	台	8.50	1	8.50
12	龙门铣	生产设备	GMC3080GRV	台	228.00	2	456.00
13	龙门铣	生产设备	GMC2040GRV	台	112.00	2	224.00
14	铣边龙门铣	生产设备	CX6020	台	89.80	1	89.80
15	加工中心	生产设备	BF-V6	台	26.00	8	208.00
16	加工中心	生产设备	BF-V8	台	28.00	12	336.00
17	加工中心	生产设备	BF-2013	台	75.00	4	300.00
18	加工中心	生产设备	BF-3025	台	120.00	4	480.00
19	磨床	生产设备	105SA1	台	89.00	1	89.00
20	手摇磨床	生产设备	ACC450ST	台	12.00	1	12.00
21	手摇磨床	生产设备	HF-618S	台	4.10	4	16.40

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
22	普通车床	生产设备	CA6140B/A/1500	台	6.70	2	13.40
23	数控车床	生产设备	CAK50135	台	13.00	4	52.00
24	摇臂钻床	生产设备	Z3050×16/1	台	7.98	2	15.96
25	镗床	生产设备	BMC-110R ₂	台	270.00	1	270.00
26	五面体加工中心	生产设备	ML-540Z2	台	408.00	1	408.00
27	钻攻机	生产设备	ZQS4116/I	台	0.40	5	2.00
28	线切割	生产设备	CDK63	台	6.10	6	36.60
29	普铣	生产设备	X63254	台	3.10	10	31.00
30	车铣复合加工中心	生产设备	GLS-3300/LM	台	86.00	1	86.00
31	移动平台影像仪	研发设备	/	台	30.00	1	30.00
32	2.5D 投影仪	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
33	三坐标测量仪	研发设备	/	台	50.00	1	50.00
34	轮廓测量仪	研发设备	/	台	15.00	1	15.00
35	表面粗糙度测量仪	研发设备	/	台	10.00	1	10.00
36	硬度测试机	研发设备	/	台	10.00	1	10.00
37	高度测量仪	研发设备	/	台	5.00	2	10.00
38	非接触式白光高度测试平台	研发设备	/	台	12.00	1	12.00
39	高倍率金像显微镜	研发设备	/	台	50.00	1	50.00
40	激光干涉仪	研发设备	/	台	30.00	1	30.00
41	光谱分析仪	研发设备	/	台	15.00	1	15.00
42	拉力测试仪	研发设备	/	台	10.00	1	10.00
43	线轨老化测试平台	研发设备	/	台	12.00	3	36.00
44	线轨噪音测试平台(含分贝仪)	研发设备	/	台	7.00	2	14.00
45	工作台	研发设备	/	台	0.50	10	5.00
46	恒温恒湿箱	研发设备	/	台	1.70	1	1.70
47	置物箱(带防潮)	研发设备	/	台	0.30	5	1.50
48	视觉打光测试平台(含各种光源)	研发设备	/	台	15.00	1	15.00
49	视觉镜头测试平台(含各种镜头)	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
50	低速示波器	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
51	高速示波器	研发设备	/	台	100.00	1	100.00
52	灵敏电流计	研发设备	/	个	20.00	1	20.00
53	万用表	研发设备	/	个	5.00	2	10.00
54	信号发生器	研发设备	/	个	10.00	1	10.00
55	结构设计软件 3D	研发软件	/	套	7.50	20	150.00
56	辅助设计软件 2D	研发软件	/	套	0.50	30	15.00
57	力学仿真软件	研发软件	/	套	25.00	1	25.00
58	专业渲染软件	研发软件	/	套	30.00	1	30.00

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
59	设计插件软件	研发软件	/	套	0.05	50	2.50
60	计算机辅助制造	研发软件	/	套	15.00	5	75.00
61	算法开发、数据分析软件	研发软件	/	套	5.00	5	25.00
62	测试开发软件	研发软件	/	套	4.00	5	20.00
63	程序开发软件	研发软件	/	套	2.00	10	20.00
合计							5,380.16

3、预备费

根据项目生产经营情况，在对整个项目所需流动资金进行合理预算的前提下，本项目拟计划投入预备费，用于项目实施期间由于价格、设计变更等原因引起工程造价变化的开支；本项目的预备费为 596.28 万元，不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。

4、铺底流动资金

本项目铺底流动资金为 3,000 万元，主要综合考虑未来项目应收账款、存货、货币资金等经营性流动资产以及应付账款等经营性流动负债的情况对流动资金的需求等因素的影响而设置，系项目运营早期为保证项目正常运转所必须的流动资金，不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。

由上可知，半导体先进封装测试设备研发及生产项目投资总额为 12,521.87 万元，包含场地投资 3,545.43 万元、设备及软件投资 5,380.16 万元、预备费 596.28 万元和铺底流动资金 3,000.00 万元，上述各项投资是在充分考虑项目实际规划所需、项目建设及运营情况、项目不确定支出和保障项目顺利实施等因素的基础上测算得出；其中场地投资、设备及软件投资拟使用本次募集资金，共计 8,925.59 万元；预备费、铺底流动资金不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。因而，半导体先进封装测试设备研发及生产项目投资金额的具体构成清晰明确，测算依据及测算过程具有合理性。

（三）平板显示器件自动化专业设备生产建设项目

“平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”系首次公开发行股票并上市时尚未募足所需投资总额的募集资金投资项目，根据整体建设进度计划，该项目本次发行拟使用募集资金金额系截至本次发行董事会召开日尚未投资建设的一部分，具体资金投入情况如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)	是否为资本性支出
1	场地投资	22,611.97	5,307.91	是
1.1	场地建设费	14,895.32	-	是
1.2	场地装修费	7,716.65	5,307.91	是
2	设备及软件投资	2,195.97	-	是
3	铺底流动资金	1,000.00	-	否
合计		25,807.94	5,307.91	/

平板显示器件自动化专业设备生产建设项目的各项规划投资（详情参见《深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第九节 募集资金运用与未来发展规划”）中拟使用本次募集资金的场地投资中的场地装修费，金额为5,307.91万元；上述场地装修费是在募投规划建筑面积的基础上，参考募投项目实施地当时的市场价格确定，其中装修费明细如下：

序号	项目	建筑面积 (m ²)	装修费 (万元)	拟使用本次募集资金金额 (万元)	单位装修价格 (元/m ²)
1	厂房	56,039.05	5,603.91	5,307.91	1,000.00
2	宿舍楼	8,442.60	1,013.11	-	1,200.00
3	办公楼	5,674.11	680.89	-	1,200.00
4	其他附属及配套设施	5,344.80	418.74	-	783.45
合计		75,500.56	7,716.65	5,307.91	1,022.07

本次募投项目实施地点为惠州市，根据公开资料显示，其他上市公司在惠州市新建项目场所装修的具体情况如下：

公司名称	项目名称	装修费 (万元)	建筑面积 (m ²)	单位装修价格 (元/m ²)
科达利	惠州动力锂电池精密结构件新建项目（厂房及宿舍）	11,751.20	153,680.00	764.65
奥拓电子	Mini LED 智能制造基地建设 项目	1,125.00	7,500.00	1,500.00

由上可知，其他上市公司披露的惠州地区募投项目场所的装修单位造价根据各个公司的实际情况设定，存在一定的跨度空间，考虑到装修本身具有一定的弹性，公司平板显示器件自动化专业设备生产建设项目装修单位造价根据自身需求和当时装修市场情况设计规划，在上述可比项目的跨度范围内，具有合理性。

综上所述，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目和平板显示器件自动化专业设备生产建设项目投资金额的具体构成清晰明确，测算依据及测算过程具有合理性。

二、根据投资构成中非资本性支出的情况及《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第4问，补充流动资金比例是否超过募集资金总额的30%

发行人本次募集资金用于惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目和平板显示器件自动化专用设备生产建设项目的部分拟全部用于场地建设、场地装修、设备及软件购置等，均为资本性支出，不存在非资本性支出的情况；发行人本次募集资金用于补充流动资金的金额为10,000.00万元，占本次拟募集资金总额比例为27.78%，未超过本次募集资金总额的30%。

三、申报会计师的核查程序和核查意见

（一）核查程序

申报会计师履行了以下主要核查程序：

- 1、获取投资项目的具体构成、测算依据资料和测算过程表，核查是否合理；
- 2、核查投资构成中的非资本性支出情况，与《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第4问进行比对，核查补充流动资金比例是否超过募集资金总额的30%。

（二）核查结论

- 1、惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目和平板显示器件自动化专用设备生产建设项目投资金额的具体构成、测算依据及测算过程具有合理性；
- 2、本次募集资金用于补充流动资金的金额为10,000.00万元，占本次拟募集资金总额比例为27.78%，未超过本次募集资金总额的30%。

2.关于收益测算

根据首轮回复，1) 深科达智能制造创新示范基地续建工程两个子项目的相关产品预计销量是根据公司研发水平、产品竞争优势、下游市场需求，配合公司的市场和客户调研做出的。2) 相关成本费用参照近几年企业的历史数据及项目实际进行测算。

请发行人说明：（1）销量预计依据的详细情况，结合公司市场地位、可比公司同类产品销量或规划销量，销量预计是否审慎、合理；（2）结合该项目与公司近几年历史项目的差异，成本费用的测算方法是否合理，列表对比募投项目与公

司历史的成本费用占比，相关成本费用测算是否完整。

请申报会计师核查并发表意见。

回复：

一、销量预计依据的详细情况，结合公司市场地位、可比公司同类产品销量或规划销量，销量预计是否审慎、合理

（一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目

1、销量预计依据的详细情况

鉴于本项目针对的 Mini/Micro-LED 显示模组组装和检测设备暂无权威统一的市场需求预测数据，公司综合考虑未来新型显示行业的市场发展情况、潜在客户的需求状况、公司产品或服务的竞争优势、公司的销售策略等因素，结合公司自身业务发展规划情况确定本次募投项目产品的销售数量，具体如下：

深科达在智能装备领域深耕多年，积累了深厚的技术储备和丰富的项目管理经验，具备了较强的自动化整合优势，致力于为客户提供全自动一体化综合解决方案，故而本次募投项目规划产品设定为全自动组装和检测自动化生产线。

此外，公司已经于 2021 年参与苹果公司 Mini-LED 背光显示屏幕产品生产线的构建，初步构建规模为两条，，公司主要负责平板显示 IC 支架组装设备和其他部分辅助设备，上述产品已经实现了销售。根据与客户的沟通情况，预计未来会有另外 4 条线（此处每条产线系针对 Mini-LED 背光显示屏的完整背光组装和检测自动线，具体由募投规划的 6 种产品组成，下同）的设备需求；同时，公司与一家非苹果公司也进行了初步沟通获取了需求信息，预计需求为 2 条生产线，因而合理预计未来 2-3 年会有 6 条线的设备采购需求，基于谨慎性原则，本项目预计销量在实施后第三年（达产第一年）的产能释放率设定为 11 条线的 50%，考虑到随着 Mini/Micro-LED 显示技术的不断成熟和市场空间的逐渐扩大，公司销售也将随之拓展的情况，故而采用渐进式释放产能的方式，设定 100%达产规划为 11 条自动线。此外，根据立鼎产业研究中心数据，2018 年全球 Mini/Micro-LED 市场规模为 2,810 万美元，其中 Mini-LED 占比为 35.6%，达 1,000 万美元。到 2024 年，全球 Mini-LED 市场规模将达 23.2 亿美元，2018-2024 年复合增长率将达到 147.9%，下游市场的预计增长速度远超本次募投规划产能释放速度，说明本次销量规划具备一定的审慎性。

2、结合公司市场地位、可比公司同类产品销量或规划销量，销量预计是否审慎、合理

（1）公司市场地位

公司一直致力于自主研发和知识产权的保护及转化应用，是国家级高新技术企业，先后获得了“工信部认定第一批专精特新‘小巨人’企业”“广东省高能效显示面板智能装备工程技术研究中心”“广东省第五批机器人骨干（培育）企业”“广东省信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业”“广东省战略性新兴产业培育企业（智能制造领域）”“广东省著名商标”“入选‘广东省智能制造试点示范项目’”“入选‘深圳市 2019 年度战略性新兴产业专项资金新兴产业扶持计划第四批资助项目’”“入选‘深圳市 2018 年第一批战略性新兴产业和未来产业专项资金扶持计划项目’”“入选‘深圳市 2017 年首台（套）重大技术装备应用扶持计划项目’”“第四届全球触控、蓝宝石行业最具影响力企业评选优秀供应商”“第十四届深圳企业创新纪录奖”等殊荣。

通过多年的持续努力，公司突破并掌握了精准对位、图像处理、运动控制、精密压合贴附等方面的核心技术，已具备提供涵盖 OLED 和 LCD 显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力，并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力，可为客户提供一站式解决方案，是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一。依靠先进的技术、稳定的产品性能、完善的售后技术支持，公司产品获得了天马微电子、华星光电、业成科技、华为、京东方、维信诺、友达光电、伯恩光学、蓝思科技、欧菲光等境内外知名企业的一致认可，在平板显示器件生产设备行业有较高的美誉度和品牌影响力。

此外，公司与主要竞争对手经营情况的对比（2021 年 6 月末/1-6 月）情况如下表：

单位：万元

公司名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润	综合毛利率
联得装备	227,946.43	142,559.44	44,806.26	1,088.90	25.41%
易天股份	136,700.96	80,815.19	20,822.06	4,820.87	48.97%
鑫三力	116,094.93	41,722.39	16,809.07	-5,815.44	32.18%
集银科技	50,486.02	18,925.22	14,465.92	-949.86	27.75%
平均值	132,807.08	71,005.56	24,225.83	-213.88	33.71%
深科达	140,730.56	77,319.80	41,351.67	3,611.20	34.37%

注：1) 鑫三力为上市公司智云股份的子公司，其财务数据来源于智云股份 2021 年半年度报告，其中资产总额、资产净额、营业收入、净利润是鑫三力的财

务指标，综合毛利率为智云股份平板显示模组设备对应数据；

2)集银科技是上市公司正业科技的子公司，其财务数据来源于正业科技2021年半年度报告，其中资产总额、资产净额、营业收入、净利润是集银科技的财务指标，综合毛利率为正业科技平板显示模组自动化对应数据。

2018年-2021年上半年，公司与主要竞争对手的研发投入占营业收入对比情况如下表：

公司名称	研发投入占比			
	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
联得装备	9.93%	8.50%	9.72%	8.59%
易天股份	9.82%	9.42%	7.17%	6.67%
正业科技	7.50%	9.36%	11.60%	8.24%
智云股份	16.25%	5.25%	19.58%	4.19%
平均	10.87%	8.13%	12.02%	6.92%
深科达	8.42%	9.38%	10.09%	9.46%

注：由于集银科技和鑫三力研发投入信息未公开，故与其上市母公司公开数据进行对比。

2018年-2021年上半年，公司与主要竞争对手的研发人员占员工总数比例对比情况如下表：

公司名称	研发人员占比			
	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
联得装备	35.43%	28.33%	29.31%	27.80%
易天股份	/	29.73%	31.36%	27.02%
正业科技	/	32.29%	32.24%	27.15%
智云股份	/	22.18%	18.44%	17.45%
平均	/	28.13%	27.84%	24.86%
深科达	26.50%	29.53%	36.52%	36.67%

注：由于集银科技和鑫三力研发人员和员工数量信息未公开，故与其上市母公司公开数据进行对比。

截至2021年6月30日，公司与同行业可比公司拥有的授权专利和软件著作权对比情况如下表：

公司名称	获得授权专利和软件著作权情况
联得装备	截至2019年6月末，已获授权专利83项，计算机软件著作权授权49项
易天股份	截至2021年6月末，已获得授权专利112项，软件著作权88项

公司名称	获得授权专利和软件著作权情况
正业科技	截至2021年6月末，已获授权发明专利130余件，软件著作权共180余件
智云股份	截至2021年6月末，已获授权专利140项，计算机软件著作权授权65项
深科达	截至2021年6月末，已获授权专利277项，计算机软件著作权授权38项

注：由于集银科技和鑫三力专利和软件著作权信息未公开，故与其母公司公开数据进行对比；联得装备未公布截至2019年6月末之后的专利和软件著作权信息，故选取其已公开的截至2019年6月30日的数据进行对比。

由上可知，与同行业可比公司相比，深科达在业务经营方面、研发投入、研发人员规模、专利和计算机软件著作权保有量等方面具有一定的优势和市场地位。

公司多年来在平板显示领域的积累，为本次募投项目预计销量的顺利实现奠定了坚实的技术、客户和市场基础。

(2) 可比公司同类产品销量或规划销量

根据公开披露信息，除发行人外，参与 Mini/Micro-LED 相关设备研制和生产的还有联得装备（300545.SZ）、智云股份（300097.SZ）、华兴源创（688001.SH）和精测电子（300567.SZ），相关信息如下：

公司名称	相关产品	相关产品销量/达产规划
联得装备	Mini-LED ACF 贴附&COFPunch 设备、Mini-LED 全自动 PCB 绑定设备	未披露
智云股份	已公布设立研发中心进行研究	未披露
华兴源创	Mini/Micro-LED 和 Micro-OLED 平板显示检测设备	新项目规划销量： Mini/Micro-LED 和 Micro-OLED 平板显示自动化检测设备，新增产能 40 台/年； Micro-OLED Mura 检测及修复设备，新增产能 18 台/年； 规划销售收入：20,010.00 万元/年
精测电子	Micro-LED 显示全制程检测设备	新项目规划销量： Micro-LED 光学仪器测量设备，新增产能 650 台/年； Micro-LED 检测与修复设备，新增产能 140 台/年； 基于 AI 的 Micro-LED 面板柔性检测设备，新增产能 80 台/年； Micro-LED 芯片 ATE 设备，新增产能 30 台/年； 规划销售收入：69,300.00 万元/年

信息来源：上市公司公开披露文件。

由上表可知，Mini/Micro-LED 产品生产技术尚未成熟，Mini/Micro-LED 屏幕应用产品的大规模商业化并未完全落地，国内针对 Mini/Micro-LED 显示模组的组装和检测设备生产厂家主要系深耕显示装备领域的少数企业，数量相对有限，上述参与者规划的产品基本都是单机类型的设备，公司本次规划产品均为自动线，具有一定的优势。

综上，公司综合考虑了未来新型显示行业的市场发展情况、潜在客户的需求状况、公司产品或服务的竞争优势、公司的销售策略、同行业在该领域的布局进程等因素，结合公司自身业务发展规划情况以确定本次募投项目产品的销售数量；公司利用自身在平板显示设备领域积累的技术优势和市场地位，紧抓 Mini/Micro-LED 新型显示产业的发展机遇期，为本次募投项目规划产品预计销量的顺利实现奠定了良好的基础，因而本次募投项目的销量预计具有审慎性和合理性。

（二）半导体先进封装测试设备研发及生产项目

1、销量预计的详细情况

公司综合考虑半导体封测设备行业的市场发展情况、潜在客户的需求状况、公司产品研发计划、公司的销售策略等因素，结合公司自身业务发展规划情况确定本次募投项目产品的销售数量，具体如下：

（1）市场规模预测

行业上一般根据产品工艺复杂程度、封装形式、封装技术、封装产品所用材料是否处于行业前沿，通常将带有倒装芯片(FC)结构的封装、圆片级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、3D封装等划分为先进封装范畴，随着摩尔定律逐步放缓，芯片设计逐步进入瓶颈期，材料和封装技术的进步越来越受到芯片厂商的重视，目前先进封装主要有两种技术路径：一种是减小封装体积，使其接近芯片本身的大小，这一技术路径统称为晶圆级芯片封装(WLCSP)；另一种封装技术是将多个裸片(Die)封装在一起，提高整个模组的集成度，这一技术路径叫做系统级封装(SiP)。本次募投项目是针对先进封装的工艺特点进行规划的，其中探针台和划片机在先进封装和非先进封装中都能适用，固晶机是针对先进封装技术的之一的平板级封装(PLP)技术研制的，AOI检测设备是针对先进封装工艺下晶粒颗粒度更小、结构更复杂的特点研制的，本次募投项目旨在构建一条一体化全自动封装测试线。

根据 SEMI 国际半导体产业协会数据，2020 年全球半导体设备市场规模 712 亿美元，同比增长 19.06%，创历史新高，2015-2020 年复合增速 14.30%。芯片产能紧张局势仍将延续，预计未来两年半导体设备将继续保持高景气度。区域分布上，2020 年中国大陆和中国台湾半导体设备规模分别为 187.2 亿美元和 171.5 亿美元，分别占全球市场的 26.26%和 24.16%，中国大陆成为全球半导体设备第一大市场。同时 SEMI 预测，2021 年全球半导体设备销售额将首次突破 1000 亿美元大关，达到 1,030 亿美元，其中封装测试环节设备市场约占半导体设备市场 10%。根据 Yole

的预测,先进封装市场规模由2019年的288亿美元增长至2025年的422亿美元,占比由2019年的42.6%有望提升至2025年的49.4%。由此推算,即使以2021年全球半导体设备销售规模测算,2025年中国大陆先进封装测试设备市场规模也将达到约13.4亿美元($1030 \times 26.26\% \times 10\% \times 49.4\% \approx 13.4$,折合人民币约85亿元),基于谨慎性原则,本次测算假定后续市场规模保持85亿元不变。

(2) 市场占有率预测

根据CSA Research、中国半导体行业协会及SEMI数据,预计2022年全球半导体测试设备将达到56.12亿美元,预计2022年我国半导体测试设备规模将达到103.22亿元。根据SEMI数据,2018年我国测试机、分选机、探针台投资规模分别占测试设备总规模的63.10%、17.40%、15.20%。以此半导体产线投资配置比例测算,则2022年我国半导体测试分选机市场规模约为83.08亿元。公司半导体测试分选设备2021年预计收入为2.50-3.00亿元,基于谨慎性原则在假定不增长的情况下,2022年公司半导体测试分选设备的市场占有率约为2.41%-3.41%,相应的公司规划本次募投项目在项目实施后第五年达到稳产后的市场占有率也为该区间。

基于以上测算数据,规划本次募投项目的规划稳产后的销售收入区间为2.05-3.07亿元($85 \text{ 亿元} \times \mathbf{【2.41\%-3.41\%】} \approx \mathbf{【2.05-3.07】}$ 亿元),区间中值为2.56元。

同时,考虑到:1)发行人本次募投项目针对的客户群体为国内大型封测厂商,在该领域发行人已经积累了一定的客户资源,与扬杰科技、华天科技、通富微电、山东晶导微电子股份有限公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司等企业建立了合作关系,充分掌握了客户的实际需求;2)深科达拟利用自身在智能装备领域的自动化整合优势,旨在帮助客户构建一体化全自动封装测试线以达到提升生产效率、降低生产成本的目的;3)根据封装测试产线的设备配比情况,考虑到自身研发水平和研发项目的进展状况,对募投产品的数量进行调整,再依照2-3亿元的收入规模和预估设备销售单价分配各类设备的预计销售数量,进而最终确定本次募投项目产品的销售数量。

2、结合公司市场地位、可比公司同类产品销量或规划销量,销量预计是否审慎、合理

(1) 公司市场地位

基于对半导体行业发展的判断,深科达整合自身技术优势,通过子公司深科

达半导体于 2016 年切入半导体封测设备领域，并陆续向市场推出测试分光机、测试分选机等半导体封测系列产品。报告期内，半导体封测设备的销售收入分别为 2,164.71 万元、3,992.99 万元、12,051.82 万元和 20,316.47 万元，年复合增长率高达 135.95%，相关产品获得了市场的广泛认可，与扬杰科技、华天科技、通富微电、山东晶导微电子股份有限公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司等企业建立了合作关系，累计积累了众多优质客户群体，市场占有率逐年提升。

半导体后道测试设备主要包括测试机、分选机、探针台三大类，根据 SEMI 数据，2018 年我国半导体测试设备中，测试机、分选机和探针台的占比分别为 63.10%、17.40%和 15.20%，其中探针台和分选机的市场空间容量差距不大。深科达半导体目前的主要产品为分选机，在该细分领域，国内分选机龙头为长川科技，深科达半导体与长川科技 2018 年-2021 年上半年的分选机销售对比情况如下：

公司名称	营业收入（万元）			
	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
长川科技（A）	38,166.30	55,873.35	26,398.23	11,753.63
深科达半导体（B）	10,443.47	12,051.82	3,992.99	2,164.71
A/B	3.65	4.64	6.61	5.43

此外，根据深科达 2021 年年度业绩快报，公司 2021 年度分选机销售收入约为 2.72 亿元（未经审计），近年来深科达半导体分选机的销售收入保持快速增长态势。

公司多年来在半导体封测设备领域的积累，为本次募投项目预计销量的顺利实现奠定了坚实的技术、客户和市场基础。

（2）可比公司同类产品销量或规划销量

根据公开披露信息，除发行人外，参与本次募投规划涉及相关设备研制和生产的企业还有新益昌（688383.SH）、长川科技（300604.SZ）、光力科技（300480.SZ）、华兴源创（688001.SH）和联得装备（300545.SZ），相关信息如下：

公司名称	已有产品/规划项目	相关产品销量/规划销量
新益昌	半导体固晶机	2020 年和 2019 年销售收入分别为 2,170.33 万元和 2,268.21 万元,销量为 89 台和 103 台
长川科技	探针台研发及产业化项目	新项目规划销量： 探针台 485 台，其中 CP12-SOC/CIS（200 台）、CP12-Memory（120 台）、CP12-Discrete（75 台）、CP12-SiC/GaN（90 台）； 规划销售收入：40,740.00 万元/年
光力科技	半导体智能制造产业基地项目（一期）	新项目规划销量： 划片机 300 台； 规划销售收入：64,200.00 万元/年

公司名称	已有产品/规划项目	相关产品销量/规划销量
华兴源创	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	新项目规划销量：每年新增 SIP 分选机 70 台（套），SIP 测试机 70 台（套），治具及配件 8,960 个； 规划销售收入：49,532.00 万元/年
联得装备	半导体封测智能装备建设项目	新项目规划销量：COF 倒装设备 50 套，IGBT 芯片及模组封装设备 50 套； 规划销售收入：23,000.00 万元/年

注：上述信息来源于上市公司公开披露信息；另外表中探针台也可称为 CP 测试机。

本次募投项目规划主要产品的国内市场份额目前主要由境外企业占据，国内参与企业较少，其国内市场容量以及国内可比公司已有销售或已规划募投项目预测销量的情况如下：

1) 探针台

根据 CSA Research、中国半导体行业协会及 SEMI 数据，预计 2022 年全球半导体测试设备将达到 56.12 亿美元，预计 2022 年我国半导体测试设备规模将达到 103.22 亿元。根据 SEMI 数据，2018 年我国测试机、分选机、探针台投资规模分别占测试设备总规模的 63.10%、17.40%、15.20%。以此半导体产线投资配置比例测算，则 2022 年我国探针台的市场规模约为 15.69 亿元。

根据公开信息，国内参与探针台研发和销售的企业主要有长川科技（300604.SZ）和矽电半导体设备(深圳)股份有限公司，其中长川科技通过探针台研发及产业化项目规划了年产 300 台探针台和 40,740.00 万元/年销售收入，矽电半导体设备(深圳)股份有限公司已实现了销售，但无公开数据；本次募投项目规划达产 100%后实现年销售划片机 40 台，销售金额为 1,920.00 万元；本次募投项目规划金额相比同行业可比公司募投项目的规划金额和国内市场空间都较小，具有谨慎性和合理性。

2) 划片机

根据 SEMI 数据，2021 年全球封装设备市场规模为 69.9 亿美元，2015-2021 年的复合增长率达 18%，预计 2022 年将继续增长至 72.9 亿美元，对应 2022 年划片机的市场空间约为 20.4 亿美元，我国封装环节较为成熟，行业市场约占全球四分之一，预计 2022 年半导体划片机市场空间在 32-36 亿人民币。

目前国内参与划片机设备生产和研发的企业不多，根据公开信息，光力科技（300480.SZ）通过半导体智能制造产业基地项目（一期）规划了年产 300 台划片机和 64,200.00 万元/年的销售收入；本次募投项目规划达产 100%后实现年销

售划片机 40 台，销售金额为 3,120.00 万元；本次募投项目规划规划金额相比同行业可比公司募投项目的规划金额和国内市场空间都较小，具有谨慎性和合理性。

3) 固晶机

根据 Yole development，预计 2024 年全球半导体固晶机市场将达到 10.83 亿美元（约为 68.95 亿人民币），按照 SEMI 数据统计 2020 年中国大陆和中国台湾半导体设备规模分别占全球市场的 26.26%和 24.16%比例测算，2024 年中国大陆半导体固晶机市场规模约为 18.11 亿元（不考虑中国大陆市场占比提升的因素）。

新益昌（688383.SH）是国内半导体固晶机领域的代表，根据公开披露信息，新益昌 2020 年和 2021 年上半年实现半导体固晶机收入分别 2,170.33 万元和 5,287.08 万元，以此推算 2021 年度全年为 10,574.16 亿元（暂按照半年度数据乘以 2 进行测算）；本次募投项目规划达产 100%后实现年销售固晶机 120 台，销售金额为 14,400.00 万元；上述规划销量相比国内市场需求而言，占比相对较小，谨慎性和合理性。

4) AOI 检测设备

按照 SEMI 数据测算，2018 年半导体检测&量测设备约占半导体设备投资总额的 11%，预计 2020 年全球检测&测量市场空间约为 64.7 亿美元，其中中国大陆该市场规模约为 16 亿美元，在检测&量测设备中，缺陷检测与量测部分占比分别约为 2/3、1/3，则相应 2020 年国内半导体缺陷检测设备的市场规模约为 10.7 亿美元（68.11 亿元人民币）。

本次募投项目规划的 AOI 检测设备属于半导体缺陷检测设备的一种，设备较为细分，暂无清晰准确的同行业可比公司信息。本次募投项目规划达产 100%后实现年销售 AOI 检测设备 50 台，销售金额为 3,250.00 万元；该规划销量相比国内市场需求而言，占比较小，具有谨慎性和合理性。

根据 SEMI 预测，2021 年全球半导体设备销售额将首次突破 1000 亿美元大关，达到 1030 亿美元。另外根据 SEMI 数据，封装测试环节设备市场约占半导体设备市场 10%，参照 2020 年中国大陆和中国台湾半导体设备规模分别占全球市场的 26.26%和 24.16%比例测算，预计 2021 年中国大陆半导体封装测试设备市场规模约为 27 亿美元（ $1030 \times 10\% \times 26.26\% \approx 27$ 亿美元，折合人民币约为 172 亿，包括先进封装和非先进封装概念的封装设备和测试设备），假定该市场规模不变的情况下，按照目前各个同行业可比公司募投项目的销售规划测算的未来市场占有率情况如下：

公司	长川科技	光力科技	华兴源创	联得装备	深科达
规划销售额（万元）	40,740.00	64,200.00	49,532.00	23,000.00	25,915.00
市场占有率	2.37%	3.73%	2.88%	1.34%	1.51%

注：本次市场占有率仅以各个公司募投规划销售额测算。

由上可知，目前国内参与本次募投项目规划所涉产品的企业并不多，除部分产品已有少量销售外，大多处于市场开拓阶段；各个企业规划的销售额相比不断扩大的国内市场需求而言，存有一定的国产替代空间，伴随着国内半导体产业的崛起和相关设备国产化趋势的不断显现，公司未来在半导体先进封装测试设备领域的发展大有可为。

综上，公司综合考虑了半导体封测设备行业的市场发展情况、潜在客户的需求状况、公司产品研发计划、同行业企业当前研制进展与布局等因素，结合公司自身业务发展规划情况以确定本次募投项目产品的销售数量；公司利用自身在半导体封测设备领域积累的技术优势和市场地位，紧抓国内半导体产业迅速发展和封测设备国产化的战略机遇期，为本次募投项目规划产品预计销量的顺利实现奠定了良好的基础，因而本次募投项目的销量预计具有审慎性和合理性。

二、结合该项目与公司近几年历史项目的差异，成本费用的测算方法是否合理，列表对比募投项目与公司历史的成本费用占比，相关成本费用测算是否完整

（一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目

惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目测算的成本费用与公司历史数据对比情况如下表：

序号	项目	本次募投项目		2020年度		2019年度	
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
1	生产成本	25,050.50	64.73%	26,270.16	60.25%	22,489.93	63.40%
1.1	直接材料费用	21,283.90	55.00%	23,463.06	53.81%	20,607.71	58.09%
1.2	人工费用	2,350.00	6.07%	796.87	1.83%	545.67	1.54%
1.3	折旧及摊销	642.64	1.66%	1,017.29	2.33%	793.86	2.24%
1.4	其他制造费用	773.96	2.00%	992.93	2.28%	542.69	1.53%
2	销售费用	4,063.29	10.50%	6,906.97	10.66%	5,513.51	11.68%
3	管理费用	2,128.39	5.50%	3,512.05	5.42%	3,401.40	7.21%
4	研发费用	3,482.82	9.00%	6,076.95	9.38%	4,762.40	10.09%
5	财务费用	-	-	416.92	0.64%	125.07	0.27%
6	税金及附加	259.59	0.67%	275.98	0.43%	222.29	0.47%
7	所得税	557.01	1.44%	628.98	0.97%	290.17	0.61%
	收入	38,698.00	/	43,604.00	/	35,475.67	/

注：本表中 2019 年和 2020 年的生产成本和收入计取的是公司当期平板显示模组类设备的数据，销售费用、管理费用、研发费用、税金及附加和所得税计取的是公司当期的合并报表数据。

由上表可知，1) 本次募投项目总的生产成本与公司历史数据相当，处于合理水平；其中直接材料费用、其他制造费用与历史数据相当；由于本项目是在自建厂房里通过购买相关设备进行自主机加工的方式生产，与原来主要在租赁厂房和机加工主要通过外协方式进行生产的情况有所不同，故而折旧及摊销与公司历史数据存在一定的差异；由于本次募投公司将加强自主生产能力的投入，增加装配和机加工人员的招聘和培养，提升订单的交期管控和产品质量控制能力，故而人工费用占比较历史数据有所增加；2) 销售费用、管理费用和研发费用与公司历史数据相当，具有合理性；3) 本项目暂未考虑财务费用；4) 本次募投项目税金及附加和所得税测算暂未考虑软件增值税即征即退的影响，故而会高于公司历史数据，具有合理性。

(二) 半导体先进封装测试设备研发及生产项目

半导体先进封装测试设备研发及生产项目测算的成本费用与公司历史数据对比情况如下表：

序号	项目	本次募投项目		2020 年度		2019 年度	
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
1	生产成本	17,215.43	66.43%	8452.31	69.63%	2869.17	71.95%
1.1	直接材料费用	13,994.10	54.00%	7942.21	65.43%	2611.02	65.48%
1.2	人工费用	2,170.00	8.37%	123.99	1.02%	94.92	2.38%
1.3	折旧及摊销	533.03	2.06%	1.65	0.01%	2.25	0.06%
1.4	其他制造费用	518.30	2.00%	384.46	3.17%	160.98	4.04%
2	销售费用	1,295.75	5.00%	904.83	7.45%	504.72	12.66%
3	管理费用	1,036.60	4.00%	441.44	3.64%	272.31	6.83%
4	研发费用	2,332.35	9.00%	432.53	3.56%	256.52	6.43%
5	财务费用	-	-	72.43	0.60%	57.15	1.43%
6	税金及附加	177.88	0.69%	41.92	0.35%	8.38	0.21%
7	所得税	578.55	2.23%	191.82	1.58%	-16.69	-0.42%
	收入	25,915.00	/	1,2138.75	/	3,987.82	/

注：本表中 2019 年和 2020 年的各类费用成本计取的是子公司深科达半导体当期的财务数据。

由上表可知，1) 本次募投项目的生产成本较子公司深科达半导体的历史数

据低，原因在于本次募投所涉产品相较于目前公司的分选测试设备在技术指标、应用范围、设备稳定性和性能方面有所优化升级，整体毛利率水平高于现有半导体类设备；其中直接材料费用、其他制造费用占比与毛利率水平相当的平板显示模组类设备的历史数据相吻合；由于本项目是在自建厂房里通过购买相关设备进行自主机加工的方式生产，与原来主要在租赁厂房和机加工主要通过外协方式进行生产的情况有所不同，故而折旧及摊销与公司历史数据存在一定差异；由于本次募投公司将加强自主生产能力的投入，增加装配和机加工人员的招聘和培养，提升订单的交期管控和产品质量控制能力，故而人工费用占比较历史数据有所增加；2）由于本项目属于研发及产业化项目，新产品占比较高，前期研发投入较相对成熟的半导体测试分选设备占比高，存在合理性；就销售费用而言，因为会利用现有的渠道和客户进行开拓，其趋势与历史数据变化保持一致；管理费用与子公司深科达半导体的历史数据相当，具有合理性；3）本项目暂未考虑财务费用；4）本次募投项目税金及附加和所得税测算暂未考虑软件增值税即征即退的影响，另外深科达半导体 2019 年所得税存在抵扣前期亏损的情况，故而本次募投项目会高于深科达半导体的历史数据，具有合理性。

综上所述，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目和半导体先进封装测试设备研发及生产项目与公司近几年历史项目数据匹配，成本费用的测算方法合理，上述项目成本费用占比与历史数据具有可比性，相关成本费用测算完整。

三、申报会计师的核查程序和核查意见

（一）核查程序

申报会计师履行了以下主要核查程序：

- 1、获取销量预测的过程表，分析其是否与发行人情况相符合，销量预计是否审慎合理；
- 2、获取该项目与近几年历史项目的数据对比情况，分析其成本费用占比是否合理，相关成本费用测算是否完整。

（二）核查结论

经核查，申报会计师认为：

- 1、发行人结合自身业务发展规划情况确定本次募投项目产品的销售数量，销量预计审慎、合理；
- 2、经该项目与近几年历史项目的数据对比情况，其成本费用占比合理，相关

成本费用测算完整。

3.关于经营情况

根据首轮回复及公开资料，1) 报告期内应收账款占各期营业收入的比重分别为45.26%、58.11%、60.84%和77.07%，最近一年及一期公司对主要客户的信用政策未发生重大变化。2) 公司报告期各期末存货跌价准备计提比例分别为 9.54%、3.06%、1.97%、1.37%，呈现下降趋势，且2019年以来低于可比上市公司平均值；2021年三季度末，发行人仍有较大金额的库存商品无对应订单，且无订单库存商品基本系交付客户试用的设备。3) 2021年前三季度，公司营业收入较上年度增长9.72%，销售费用较上年度增长22.65%，不匹配的原因包括：公司销售人员人数大幅增长；受疫情影响公司员工难以在当地及时开展工作，公司劳务外包支出大幅增长。4) 由于毛利率较高的产品收入占比下降、原材料采购成本上涨、市场竞争加剧及OEM采购占比上升，2021年1-9月公司主营业务毛利率较2020年下降6.94个百分点。5) 根据业绩快报，公司2021年营业收入同比增长 40.62%，归属于母公司所有者的净利润同比下降21.21%。

请发行人说明：（1）信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长的原因及合理性，结合报告期各期应收账款逾期情况，是否存在重大坏账风险；（2）2021年三季度末无订单商品的试用及销售情况，存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值的原因及合理性，进一步论证计提是否充分；（3）结合公司业务规模扩大情况，分析公司销售人员人数及劳务外包支出同时大幅增长的合理性；（4）原材料市场价及采购价的变动情况是否一致，毛利率下降趋势是否持续，是否对公司经营构成重大不利影响，本次募投项目建成后对公司毛利率的影响；（5）2021年营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配的原因及合理性，公司生产经营是否出现重大不利变化。

请发行人根据回复完善“重大事项提示”及“风险因素”相关内容，按照重要性进行排序，增强针对性。

请申报会计师核查并发表意见。

回复：

一、信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长的原因及合理性，结合报告期各期应收账款逾期情况，是否存在重大坏账风险

（一）信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长的原因

及合理性

公司客户收款政策主要为“预收定金-发货款-验收款-质保金”的形式，另外公司根据客户的订单规模、合作程度、商业信用和结算需求以及双方商业谈判的情况，对主要客户信用政策稍作调整，每期付款的金额、比例及时间也存在差异。

最近一年一期对主要客户的付款方式如下：

主要客户名称	2021年1-9月	2020年度
业成科技（成都）有限公司	1、交机后 90 天内 TT80%，最终验收后 90 天内 TT20%； 2、交机后 90 天内 TT70%，最终验收后 90 天内 TT30%； 3、最终验收月份 25 日后 90 天内支付 100%； 4、最终验收后 90 天内支付 100%	1、最终验收月份 25 日后 60 天内支付 100%； 2、交机后 60 天内 TT80%，最终验收后 60 天内 TT20%； 3、最终验收后 60 天内支付 100%； 4、最终验收后 90 天内支付 100%； 5、最终验收月份 25 日后 120 天内支付 100%； 6、最终验收月份 25 日后 90 天内支付 100%； 7、交机后 90 天内 TT80%，最终验收后 90 天内 TT20%
成都京东方光电科技有限公司	送货并开具发票后支付 90%，最终验收支付 10%	
绿点科技（无锡）有限公司	1、验收后 90 天付全额；2、验收后 100% T/T	/
南京一克思德科技有限公司	到货并提供发票支付 90%，质保期满后支付 10%	到货后 90 天付 60%，现场验收后 90 天付 30%，质保一年后 90 天付 10%
高视科技（苏州）有限公司（更名前：惠州高视科技有限公司）	1、到货并开据发票后 30 天内，支付 60%，最终验收合格支付 30%，质保期满后 30 天内，支付 10%； 2、签订合同后 7 天内支付 30%，初步检验合格后 7 天内支付 30%，验收合格并提供发票后 7 天内支付 30%，质保期满后支付 10%； 3、签订合同后 7 天内支付 30%，验收合格并提供发票后 7 天内支付 60%，质保期满后支付 10%； 4、签订合同后支付 30%，调试合格运转正常后 30 天内支付 30%，验收合格后支付 30%，质保期满后支付 10%； 5、签订合同后支付 30%，验收合格后支付 60%，质保期满后支付 10%； 6、签订合同后支付 30%，验收合格后 30 天支付 60%，质保期满后支付 10%； 7、月结 30 天	1、合同签订后一个月内，支付 30%，货到两个月内支付 30%，验收合格收到发票后两个月内支付 30%，10%质保金 12 个月内付清； 2、货到验收合格，开具发票后 30 天内支付 80%，安装调试、最终验收合格后 30 天内支付 15%，质保期满后 30 天内支付 5%； 3、签订合同后支付 30%，验收合格后 30 天内支付 60%，质保期后支付 10% 4、验收合格后支付 100%； 5、到货验收合格，并开具增值税发票 30 天内，支付 60%，最终验收合格支付 30%，质保期满后支付 10%； 6、合同签订后 7 天内支付 30%，到货后 7 天内支付 30%，验收合格并收到发票后 7 天内支付 30%，10%质保金 12 个月内付清； 7、月结 30 天
山东晶导微电子股份有限公司	1、合同签订后付 30%，剩余 70%设备验收后分期 10 个月付清； 2、合同签订后 3 天内支付 30%，剩余 70%货款，设备到厂验收后次月开始分 10 个月付清	
湖北展拓光电科技有限公司	安装调试完成后 30 天内支付 50%，最终验收完成之日起 30 天内支付 40%，剩余款项在终验收之日起 180 天内支付	/

主要客户名称	2021年1-9月	2020年度
武汉天马微电子有限公司	1、初验收并提供发票后30天内支付70%，验收合格并提供发票后30天内支付25%，质保期满后30天内支付5%； 2、到货验收支付70%，技术验收支付30%； 3、到货验收支付70%，技术验收支付25%，质保期满支付5%	初验收并提供发票后30天内支付70%，验收合格并提供发票后30天内支付25%，质保期满后30天内支付5%
光子（深圳）精密科技有限公司	合同签订后7天内支付50%，验收合格后一个月内支付50%	1、合同签订后7天内，支付50%，验收合格并提供发票后支付50%； 2、发货前7天内，支付30%，安装调试完毕7天内，支付30%，验收合格后7天内支付30%，验收合格之日起1年内支付10%
广州国显科技有限公司	1、初验收并提供发票后30天内支付70%，最终验收并提供发票后30天内支付20%，质保期满后30天内支付10%； 2、初验收并提供发票后30天内支付90%，最终验收并提供发票后30天内支付10%	1、初验收并提供发票后30天内支付70%，最终验收并提供发票后30天内支付20%，质保期满后30天内支付10%
江苏群力技术有限公司	1、每条线90万元的定金需方支付给供方，剩余货款双方另行补充约定； 2、合同签订后支付20万元，到货支付132万元，设备验收合格后30天内支付450万元，尾款于签订合同之日起一年内付清	
江西振力达智能装备科技有限公司	1、合同签字后支付30%，设备安装调试6个月后支付60%，验收合格后一年内支付10%； 2、合同签字并提供发票后支付30%，设备安装调试后支付60%，验收合格后一年内支付10%	
蓝思科技（长沙）有限公司	1、验收合格并提供发票后90天内支付100%； 2、合同签订后15天内支付30%，送货后15天内支付30%，验收合格并提供发票后15天内支付30%，质保期满后15天内支付10%	
厦门天马微电子有限公司	1、初验收并提供发票后22天内支付70%，验收合格并收到发票后22天内支付25%，质保期满后22天内支付5%； 2、初验收并提供发票后30天内支付70%，验收合格并收到发票后30天内支付25%，质保期满后30天内支付5%	

注：由于同个客户的不同合同订单因设备的定制化程度不同，对付款条款的约定可能存在差异，因此上表的部分客户具有多条付款政策。

从上表可以看到，报告期内公司主要客户货款结算政策变动不大，货款结算政策主要依据当期交易设备情况、与客户合作关系、商务谈判等因素的不同而有一定的差异，公司整体上对主要客户信用政策未发生重大变化。

公司应收账款占营业收入的比例如下：

项目	2021-12-31	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应收账款占当期营业收入的比例	56.53%	77.07%	60.84%	58.11%	45.26%

注：上表2021年9月末的数据未作年化处理。2021年9月末应收账款占当期营业收入的比例较高，也受到其计算分母系2021年1-9月的营业收入的影响，而2018年度至2020年度的比例计算分母系该年度的营业收入。2021年末数据未经审计。

公司2018年第四季度、2019年第四季度和2020年第四季度的主营业务收入

占全年的比例分别为 26.81%、45.76%和 48.82%，2020 年第四季度确认的收入占比较高，加上信用期影响，截至年底较多货款尚在付款信用期内，导致 2020 年末应收账款余额较高，占当期营业收入的比例较高。

公司 2021 年 9 月末应收账款占当期营业收入的比例较大，一方面，公司在 2021 年第三季度确认的主营业务收入占前三季度主营业务收入的比例为 41.83%，另一方面，2021 年 9 月末应收账款占当期营业收入的比例较高，还受到其计算分母系 2021 年 1-9 月的营业收入的影响，而 2018 年度至 2020 年度的比例计算分母系该年度的营业收入。

此外，2020 年度、2021 年 1-9 月半导体设备收入金额分别为 12,051.82 万元和 20,316.47 万元，半导体设备收入增长较快。近年来，在贸易战的背景下和国内政策的支持下，半导体封测行业发展迅速，在主要设备供应商中，国外封测设备供应商竞争力较强，国内也有部分厂商在争抢赛道。报告期内，公司半导体业务正处于市场开拓前期，业务规模正在爬坡，半导体设备具有类标准化特点，公司与国内外的同行业公司产品同质化程度较高，可替代性较强，为了快速开拓市场和新客户，抢占市场先机，公司在报告期内对半导体设备的销售采用连贯、稳定且相对宽松的信用政策，信用期主要为设备验收后的 3-9 个月内支付除已交定金外的剩余货款，随着半导体设备收入的快速增长，公司期末应收账款余额也随之增长。

2021 年末，公司应收账款占营业收入的比例为 56.53%（数据未经审计），较 2019 年末、2020 年末的占比低。

报告期各期，公司应收账款占营业收入的比例与同行业可比上市公司的情况如下：

公司名称	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
联得装备	82.95%	49.19%	42.93%	38.14%
易天股份	62.89%	41.92%	33.53%	30.15%
智云股份	107.04%	47.93%	121.45%	69.67%
正业科技	62.83%	57.32%	72.24%	59.88%
可比公司平均值	78.93%	49.09%	67.54%	49.46%
深科达	77.07%	60.84%	58.11%	45.26%

注：上表 2021 年 9 月末的数据未作年化处理。2021 年 9 月末应收账款占当期营业收入的比例较高，也受到其计算分母系 2021 年 1-9 月的营业收入的影响，而 2018 年度至 2020 年度的比例计算分母系该年度的营业收入。

公司应收账款占营业收入的比重在 2020 年末较可比公司平均值高，2018 年末、2019 年末及 2021 年 9 月末均较可比公司平均值低，整体上与可比公司平均值差异较小。

2018 年末、2019 年末，公司应收账款占营业收入的比重较可比公司平均值低，主要是智云股份和正业科技的占比较高，拉高了可比公司的平均值。

2020 年末，公司应收账款占营业收入的比重较可比公司平均值高，主要系公司 2020 年第四季度营业收入占比为 48.53%，占比较高，加上信用期的影响，导致 2020 年末较大的货款尚在信用期内，应收账款占营业收入的比例较高。

2021 年 9 月末，公司应收账款占营业收入的比重与可比公司平均值差异较小。2021 年 9 月末，同行业可比公司的应收账款占营业收入的比重均大幅增长，也受到其计算分母系 2021 年 1-9 月的营业收入的影响，而 2018 年度至 2020 年度的比例计算分母系该年度的营业收入。

报告期内，公司营业收入季节性分布占比与可比公司对比情况如下表：

年份	季节	联得装备	易天股份	智云股份	正业科技	可比平均值	深科达
2021 年 1-9 月	第 1 季度	32.89%	26.38%	48.69%	36.26%	36.06%	29.00%
	第 2 季度	32.26%	40.43%	20.00%	32.56%	31.31%	29.16%
	第 3 季度	34.85%	33.19%	31.31%	31.18%	32.63%	41.84%
2020 年度	第 1 季度	20.93%	12.66%	15.94%	24.26%	18.45%	8.81%
	第 2 季度	24.02%	34.69%	22.78%	30.53%	28.00%	21.26%
	第 3 季度	28.31%	18.27%	22.89%	25.82%	23.82%	21.40%
	第 4 季度	26.74%	34.38%	38.39%	19.39%	29.73%	48.53%
2019 年度	第 1 季度	26.45%	12.56%	9.10%	23.54%	17.91%	15.43%
	第 2 季度	23.46%	37.30%	47.18%	29.41%	34.34%	19.80%
	第 3 季度	21.52%	20.85%	18.70%	34.38%	23.86%	18.97%
	第 4 季度	28.56%	29.29%	25.02%	12.66%	23.88%	45.80%
2018 年度	第 1 季度	17.71%	4.73%	18.30%	17.68%	14.60%	6.73%
	第 2 季度	26.45%	35.20%	33.70%	31.05%	31.60%	35.05%
	第 3 季度	30.35%	23.88%	27.62%	26.09%	26.98%	31.37%
	第 4 季度	25.49%	36.19%	20.38%	25.18%	26.81%	26.85%

注：上表根据各可比公司公开披露的营业收入计算所得。

公司收入具有季节性特点，但各年度的季度分布亦不完全相同，2018 年第二、三季度占比较高，2019 年与 2020 年第四季度占比最高，根据公司财务部统计 2021 年第三季度占比最高。同行业可比公司联得装备、易天股份、智云股份、正业科

技因产品细分功能、业务人员市场开拓、下游市场具体需求等因素差异，季节性波动存在差异。

公司收入季节性分布主要受签订大额订单、设备集中交付等因素的影响，公司主要客户通常在每年的第一季度制定年度采购需求计划，第二季度、第三季度向公司下达订单，在下半年生产、出货和验收，导致公司下半年确认的收入较多。此外，公司平板显示模组设备的下游终端产品主要为智能手机，智能手机通常在下半年产销两旺，从而带动上游相关设备行业在下半年的订单较多。因此，公司各季度收入占比情况符合公司所处发展阶段及专用设备制造行业特点，公司收入季节性与周期性波动的情况符合行业惯例。

综上，公司信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长，符合公司生产经营实际，具有合理性，公司虽然存在应收账款逾期情况，但不存在因客户信用较差、丧失支付能力等导致大额应收账款无法收回的情况，不存在需要通过诉讼仲裁等司法途径进行催收的应收账款。2021年9月末应收账款占营业收入比重较上年末大幅增长的趋势与同行业可比公司相匹配。

(二) 结合报告期各期应收账款逾期情况，是否存在重大坏账风险

报告期各期末，公司应收账款逾期情况如下：

单位：万元

类别	2021-9-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内	40,814.81	69.59%	27,908.55	66.04%	21,795.23	73.44%	14,728.74	65.93%
信用期外	17,833.25	30.41%	14,353.89	33.96%	7,884.08	26.56%	7,610.24	34.07%
合计	58,648.06	100.00%	42,262.44	100.00%	29,679.31	100.00%	22,338.98	100.00%

报告期各期末公司应收账款余额中信用期外占比分别为 34.07%、26.56%、33.96%和 30.41%，波动幅度较小。

报告期各期末，公司逾期应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

时间	逾期应收账款余额	期后回款金额	期后回款比例
2021-9-30	17,833.25	11,095.24	62.22%
2020-12-31	14,353.89	11,854.08	82.58%
2019-12-31	7,884.08	7,621.75	96.67%
2018-12-31	7,610.24	7,546.15	99.16%

注：上表回款统计的截止日为2022年4月11日。

由上表可知，逾期应收账款的期后回款情况较好。公司部分客户在实际结算货款的过程中，存在付款流程较长而发生逾期的情况，该类客户均为行业内知名客户，与公司合作情况良好，信用度较高，相关逾期款项期后回款情况良好。此外，也存在一部分资金较为紧张的客户发生逾期情况。公司对于逾期货款已采用如电话、邮件、发函等多种形式积极催收，且每年末根据坏账准备计提政策计提坏账准备。

报告期各期末，公司应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

时间	应收账款余额	期后回款金额	期后回款比例
2021-9-30	58,648.06	37,547.94	64.02%
2020-12-31	42,262.44	38,947.68	92.16%
2019-12-31	29,679.31	28,232.16	95.12%
2018-12-31	22,338.98	21,923.89	98.14%

注：上表回款统计的截止日为2022年4月11日。

由上表可知，发行人应收账款期后回款正常，截至2022年4月11日，报告期末应收账款已回款64.02%。

报告期各期末，公司对应收账款按账龄分析法计提坏账准备。报告期各期末，公司应收账款余额中账龄在1年以内的金额占比分别为78.92%、85.07%、85.55%和88.75%，报告期末1年以内账龄的应收账款占比较高。

报告期内，公司应收账款坏账准备金额分别为1,731.46万元、2,253.42万元、2,839.75万元和3,848.31万元，坏账准备计提充足。

公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例对比情况：

账龄	深科达	联得装备	易天股份	智云股份	正业科技
1年以内	5%	3%	5%	1%	3%
1至2年	10%	10%	15%	10%	5%
2至3年	30%	30%	30%	50%	10%
3至4年	50%	50%	50%	100%	30%
4至5年	80%	80%	80%	100%	50%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

注：可比公司的数据来自于公开披露的信息文件。

各可比公司由于客户群体和自身实际情况的不同，选用的坏账准备计提政策略有差异，但整体上差异较小。公司的坏账计提政策合理，符合谨慎性原则。

公司应收账款周转率与同行业可比公司比较情况如下：

公司简称	2021年1-9月	2020年度
联得装备	1.39	2.22
易天股份	1.58	2.28
智云股份	0.80	2.07
正业科技	1.44	1.40
平均值	1.30	1.99
深科达	1.41	1.89

数据来源：根据各可比公司公开披露的信息计算所得，其中 2021 年三季度报告未披露余额，因此可比上市公司 2021 年 1-9 月采用应收账款账面价值计算；2021 年 1-9 月的应收账款周转率未作年化处理。

由上表可知，公司应收账款周转率与可比公司平均水平差异较小。

公司客户主要为大型显示面板、模组生产和半导体封测企业，应收账款无法收回的风险较小。报告期内，公司不存在因客户破产、经营困难而发生应收账款重大损失的情况，公司应收账款坏账准备计提充分。

公司已在募集说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”之“（三）发行人的其他风险”之“2、应收账款金额较高的风险”以及“第三节 风险因素”之“三、财务风险”之“（二）应收账款金额较高的风险”对应收账款占各期营业收入的比重较高等情况进行了风险提示。

二、2021 年三季末无订单商品的试用及销售情况，存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值的原因及合理性，进一步论证计提是否充分

（一）2021年三季末无订单商品的试用及销售情况

类别	2021-9-30	
	金额（万元）	占比
无订单库存商品余额	2,192.96	100.00%
其中：期末属于试用产品	1,146.53	52.28%
期后已经销售	452.49	20.63%
期后未销售但已有订单覆盖	64.30	2.93%

注：上表销售及订单覆盖统计的截止日为 2022 年 2 月 28 日。

公司 2021 年 9 月末的库存商品余额为 6,666.77 万元，其中当时无订单金额 2,192.96 万元，期末库存商品的订单覆盖率为 67.11%。截至 2022 年 2 月 28 日，上述无订单的库存商品已经销售 452.49 万元，未销售但已签订单的金额为 64.30 万

元，两者合计 516.79 万元。

(二)存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值的原因及合理性，进一步论证计提是否充分

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为9.54%、3.06%、1.97%、1.37%，呈现下降趋势，主要系由于存货管理的持续优化带来的存货结构的改善，具体论证如下：

1、2018年起采取了更加稳健的生产和销售策略

公司 2018 年公司存货跌价准备余额较大，主要是 2016-2017 年期间，公司基于对市场发展和客户需求的预判，提前进行部分设备的生产，更快地响应客户需求，在部分业务机会中抢占先机，但同时也导致有少量设备投产后却未能如期实现销售的情况，公司于 2018 年对上述设备计提了较大比例的减值准备，同时亦自 2018 年起采取了更加稳健的生产和销售策略。

2、公司存货跌价准备计提方法合理

公司在资产负债表日，对各类存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

对于有订单支持的库存商品、发出商品、在产品，公司以销售价格减去（至完工时估计将要发生的成本及）估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

公司期末不存在无订单支持的发出商品。对于期末无订单对应的库存商品，库龄在 1 年以内的，公司参照近期同类产品销售价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；库龄在 1 年以上的，公司通过向供应商对该产品包含的材料的询价确认其可变现净值，直接人工、制造费用全额确认存货跌价准备。

对于无订单对应的在产品，库龄在 1 年以内的，公司以生产经营过程中所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；库龄在 1 年以上的，公司通过向供应商对包含的材料的询价确认其可变现净值，直接人工、制造费用全额确认存货跌价准备。

期末原材料的存货跌价准备计提方法：对于报告期期末相近 3 个月内发生采购交易的材料，公司采用近期均价确认其可变现净值。除前述以外的材料，公司通过向供应商对材料的询价确认其可变现净值。

综上，公司对各类存货采用成本与可变现净值孰低计量，符合企业会计准则的要求，具有合理性。

3、公司存货库龄结构、存货周转率及存货占总资产的比例等方面近年来进一步改善、优化

报告期各期末，发行人存货库龄分布及减值准备计提情况如下表：

单位：万元

项目	2021-9-30				2020-12-31			
	余额	占比	跌价准备	计提比例	余额	占比	跌价准备	计提比例
1年以内	27,061.58	90.59%	114.19	0.42%	21,970.37	87.29%	99.88	0.45%
1-2年	1,584.46	5.30%	91.84	5.80%	2,039.80	8.10%	191.86	9.41%
2年以上	1,225.51	4.10%	204.29	16.67%	1,159.37	4.61%	203.05	17.51%
合计	29,871.55	100.00%	410.32	1.37%	25,169.53	100.00%	494.79	1.97%

续上表：

项目	2019-12-31				2018-12-31			
	余额	占比	跌价准备	计提比例	余额	占比	跌价准备	计提比例
1年以内	12,689.04	78.63%	36.40	0.29%	11,465.98	65.93%	21.06	0.18%
1-2年	2,180.13	13.51%	133.53	6.12%	1,288.78	7.41%	278.20	21.59%
2年以上	1,269.00	7.86%	323.69	25.51%	4,635.72	26.66%	1,359.75	29.33%
合计	16,138.18	100.00%	493.61	3.06%	17,390.47	100.00%	1,659.01	9.54%

公司存货跌价准备计提比例呈现下降趋势，一方面是2018年公司对部分提前生产的设备计提了较大比例的减值准备，导致2018年度的存货跌价准备金额较高；另一方面，公司持续提升存货管理水平，存货库龄结构、存货周转率等方面进一步改善、优化。

(1) 存货跌价准备计提比例与同行业可比公司的对比情况

报告期各期，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比上市公司的情况如下：

公司名称	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
联得装备	1.93%	2.23%	1.56%	1.64%
易天股份	1.53%	1.32%	1.61%	1.39%
智云股份	24.00%	29.62%	29.88%	3.14%
正业科技	17.63%	31.66%	26.25%	4.52%
可比公司平均值	11.27%	16.21%	14.83%	2.67%
深科达	1.28%	1.97%	3.06%	9.54%

注：根据各可比公司公开披露的信息计算所得，其中2021年三季度报告未披露存货余额及跌价准备金额，因此采用2021年半年报数据。

如上表，公司 2019 年以来各期末的存货跌价准备计提比例低于可比上市公司平均值，主要原因是智云股份、正业科技 2019 年末对其无订单、销售可能性较低的产品计提了较大比例的跌价准备，拉高了平均值，且较大比例的存货跌价持续至 2021 年 6 月末。根据所查询的公开信息，具体差异情况如下：

①正业科技 2019 年末存货跌价准备余额为 14,840.64 万元，2019 年度计提金额为 13,536.41 万元，其中呆滞品对应的存货账面余额为 12,299.82 万元，存货跌价准备余额为 11,246.32 万元。根据相关公告，正业科技 2019 年出现大量呆滞品，部分存货取得订单的可能性已经不高，难以改造或者改造成本较高，因此对存货计提了较多的存货跌价准备。

正业科技 2020 年末存货账面余额为 45,166.82 万元，确认的存货跌价准备余额为 14,301.45 万元，2020 年计提存货跌价准备 8,747.72 万元，2020 年末原材料和库存商品一年以上库龄占比分别为 33.87%和 66.31%，长库龄存货较多。

②智云股份 2019 年、2020 年的存货跌价准备计提比例较高，2019 年计提金额为 18,397.66 万元，存货跌价准备的计提主要是 3C 智能制造装备业务和新能源公司。

2020 年的存货跌价准备计提比例较高，主要是针对前期发出的定制化程度高的试用机难以转化成有效订单且改造利用价值较低的存货、部分因没有明确的销售意向客户且改造利用价值较低的 LCD 平板显示模组设备、疫情后期国内口罩产能过剩导致智云股份积压的口罩机等存货计提了较多的存货跌价准备。

③联得装备和易天股份长库龄的存货相对较少、占比相对较低，同时其产品领域比较集中，因此其存货跌价准备计提比例也相对较低。

公司报告期内一年以上库龄的存货余额占比分别为 34.07%、21.37%、10.24%和 9.41%，长库龄的存货占比呈下降趋势且占比较低。考虑到长库龄存货订单覆盖率较低，相应计提的存货跌价准备通常也较多。

(2) 存货周转率与同行业可比公司的对比情况

报告期各期，公司存货周转率与同行业可比上市公司的情况如下：

公司名称	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
联得装备	1.15	1.42	1.21	1.49
易天股份	0.39	0.81	1.00	0.99
智云股份	0.65	1.89	0.46	1.45
正业科技	2.31	2.35	1.49	2.08
可比公司平均值	1.13	1.62	1.04	1.50
深科达	1.79	1.97	1.87	2.07

数据来源：各可比公司公开披露的信息计算所得。

由上表可知，最近两年一期，公司存货周转率总体比较稳定且高于同行业可比公司，公司存货周转情况良好。

(3) 存货余额占总资产的比例与同行业可比公司的对比情况

报告期各期，公司与同行业可比上市公司存货余额占总资产的比例情况如下：

公司名称	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
联得装备	20.00%	23.21%	26.79%	30.74%
易天股份	34.02%	27.54%	24.36%	39.05%
智云股份	23.78%	28.05%	35.64%	16.53%
正业科技	16.14%	20.53%	23.31%	13.87%
可比公司平均值	23.49%	24.83%	27.52%	25.05%
深科达	20.45%	23.07%	22.74%	28.19%

注：可比公司数据根据其公开披露的信息计算所得，其中 2021 年三季度报告未披露存货余额，因此可比公司 2021 年第三季度末的比例采用存货账面价值计算，深科达采用存货余额计算。

由上表可知，报告期内公司存货余额占总资产的比例分别为 28.19%、22.74%、23.07%和 20.45%，整体上呈下降的趋势，且最近两年一期的占比低于同行业可比公司的平均值。

综上，公司存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值具有合理性，主要系由于存货管理的持续优化带来的存货结构的改善、存货规模的有效管控，公司存货跌价准备计提方法合理，符合企业会计准则的规定和公司生产经营的实际情况，公司存货跌价准备计提充足。

公司已在募集说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”之“（三）发行人的其他风险”之“3、存货管理风险”以及“第三节 风险因素”之“三、财务风险”之“（三）存货管理风险”对存货价值较大的情况进行了风险提示。

三、结合公司业务规模扩大情况，分析公司销售人员人数及劳务外包支出同时大幅增长的合理性

最近一年及一期，公司营业收入、销售人员人数及劳务外包费的变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	较去年同期变动比例	2020年1-9月	与上年度变动比例	2020年度
营业收入	71,104.23	113.17%	33,355.32	9.72%	64,802.32

项目	2021年1-9月	较去年同期变动比例	2020年1-9月	与上年度变动比例	2020年度
销售人员(人)	376	48.03%	254	35.25%	278
销售费用-劳务外包费	825.79	653.05%	109.66	423.85%	157.64

注：销售人员人数按当期各月销售人员人数加总/月份数计算取整得出

公司2021年1-9月营业收入、销售人员人数以及计入销售费用的劳务外包费分别较2020年1-9月增长113.17%、48.03%和653.05%。根据公司披露的2021年年度业绩快报,公司2021年度实现的营业收入为91,124.63万元,较上年增长40.62%,营业收入与销售人员人数的变动情况相匹配。

公司2021年1-9月销售费用中的劳务外包费较2020年度增长423.85%,增长幅度较大。销售费用中的劳务外包主要为满足售后服务的需要,费用支出受产品交付地点和疫情的影响。2021年1-9月收入规模增长需要较多的售后维护服务,且之前年度已经完成的部分销售也需要持续的售后服务,劳务外包支出增长较快,主要如下:

1、报告期各期,公司主营业务收入的外销收入金额分别为623.63万元、56.43万元、3,126.92万元和1,052.84万元。外销收入主要来自台湾地区,因为疫情原因,公司员工无法抵达台湾当地对客户进行售后服务,因此在当地聘请符合条件的公司协助进行售后服务,其中2021年1-9月因对友达光电、群创光电等客户进行售后服务发生支出合计244.22万元。

2、报告期各期,国内销售业务也大幅增长。受疫情影响,公司员工在进行疫情管控的期间难以在当地及时开展工作,同时业务规模的增长使得售后服务的工作量亦有所加大,因此公司在境内因聘请符合条件的公司协助进行售后服务,而产生的支出亦增长较快。

综上,由于销售推广及售后服务的需要,公司增加了销售人员人数,同时售后服务因地域分布、阶段性需求等原因,在现有团队无法满足的情况下或基于成本效益最大化考虑,公司也相应增加了劳务外包协助售后服务。销售人员人数及劳务外包支出大幅增长,与公司营业收入增长的趋势相匹配,符合公司的业务实际,具有合理性。

四、原材料市场价及采购价的变动情况是否一致,毛利率下降趋势是否持续,是否对公司经营构成重大不利影响,本次募投项目建成后对公司毛利率的影响

(一) 原材料市场价及采购价的变动情况是否一致

公司采购的原材料主要包含电气元件、机械元件、机加钣金件、外购定制件和辅料等，具体如下：

类别	物料名称
电气元件	直线电机、开关电源、PLC、气缸、电磁阀类、光源控制器、工控机、工业相机、视觉控制系统、读码器、加密狗等
机械元件	伺服电机、机械手、减速机、UVW平台、丝杆、滚珠花键、导轨、PSM、USC等
机加钣金件	机加件、钣金件、方通、型材、管材等
外购定制件	功能模块设备、治具类、模具、压头等
辅料	电缆线、扎带、线槽、螺丝、风扇、轴承、O型圈、合页、端子、接线排等

2020年和2021年1-9月，主要大宗商品期货日均结算价如下：

大宗商品名称	2021年1-9月		2020年度
	期货结算价（日均）	变动	期货结算价（日均）
不锈钢期货（万元/吨）	1.62	19.65%	1.35
铝期货（万元/吨）	1.85	32.29%	1.40
铁矿石期货（元/吨）	1,032.47	36.58%	755.94
铜期货（万元/吨）	6.76	38.77%	4.87

注：上表数据来源于同花顺 iFinD，其中不锈钢期货、铝期货和铜期货均为上海期货交易所的结算价，铁矿石期货为大连商品交易所的结算价。

2021年，铜、铁、铝等大宗商品价格普遍上涨，芯片供求关系较为紧张、产能不足也导致芯片的价格大幅上涨，传导到下游电气元件、机械元件、机加钣金件等行业，导致电气元件、机械元件、机加钣金件等原材料价格上涨。

2021年1-9月，公司电气元件、机械元件平均采购单价较2020年度分别上涨56.12%和11.88%，机加钣金件平均采购单价较上年度上涨11.40%（其中，深科达上涨27.87%，深科达微电子上涨21.81%，深科达半导体上涨6.72%，线马科技因采购的机加钣金件价小量大、不具有可比性而未纳入统计范围）。此外，外购定制件和辅料的平均采购单价也较上年上涨。

以下表的原材料为例，公司原材料2021年度较2020年度的平均采购单价与市场价格的变动情况如下：

序号	采购类别	品名	规格	公司采购单价变动	市场价格变动
1	辅料	电缆线(通用件)	3芯线_0.3m m ² _黑色	29.3%	23.69%
2	辅料	电缆线(通用件)	3芯线_2.5m m ² _黑色	21.1%	15.81%
3	辅料	电缆线(通用件)	4芯线_0.3m m ² _黑色	36.8%	30.89%
4	辅料	电缆线(通用件)	6芯线_0.3m m ² _黑色	29.9%	24.29%
5	辅料	电缆线(通用件)	8芯线_0.3m m ² _黑色	27.7%	22.13%

序号	采购类别	品名	规格	公司采购单价变动	市场价格变动
6	辅料	电线(通用件)	1芯线_25m m ² _红色	81.9%	74.01%
7	辅料	电线(通用件)	1芯线_25m m ² _蓝色	84.0%	76.01%
8	辅料	电线(通用件)	1芯线_1.5m m ² _蓝色	47.1%	40.68%
9	辅料	电线(通用件)	1芯线_1.5m m ² _红色	36.2%	30.27%
10	辅料	电线(通用件)	1芯线_2.5m m ² _红色	49.4%	42.94%
11	电气元件	漏电断路器_施耐德	IC65N-D6A/2P VE30MA	5.3%	3.25%
12	电气元件	漏电断路器_施耐德	IC65N-D10A/3P VE30MA	9.0%	6.88%
13	电气元件	漏电断路器_施耐德	IC65N-D16A/2P VE30MA	6.3%	4.23%
14	电气元件	漏电断路器_施耐德	IC65N-D32A-3P VE100MA	3.7%	1.77%
15	电气元件	塑壳式漏电断路器_施耐德	EZD160M-3p_80A_EL(0.1-0.3-0.5-1A 可调)	5.9%	3.89%
16	电气元件	塑壳式漏电断路器_施耐德	EZD160M-3p_125A_EL(0.1-0.3-0.5-1A 可调)	2.5%	0.59%
17	电气元件	塑壳式漏电断路器_施耐德	EZD160M-3p_160A_EL(0.1-0.3-0.5-1A 可调)	3.7%	1.72%
18	外购定制件	滚珠丝杆_HIWIN	SKDR030094-R20-20K2-FSC-640-750-0.012	7.4%	2.50%
19	外购定制件	滚珠丝杆_HIWIN	SKDR030095-R20-20K2-FSC-440-550-0.012	8.0%	3.06%
20	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030483-SFURL1610-DGC5-380-P1	5.0%	1.18%
21	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030373-SFV03220-2.7-DGC5-1530-P2&75 分贝以下	6.7%	2.84%
22	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030324-SFHR03232-DGC5-1860-P2-SS/75 分贝以下	10.0%	6.02%
23	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030226-SFS04020-2.8-DGC5-420-P0/75 分贝以下	10.0%	6.00%
24	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030374-SFS04020-2.8-DGC5-490-P0&75 分贝以下	6.7%	2.79%
25	外购定制件	滚珠丝杆_HIWIN	SKDR030094-R20-20K2-FSC-640-750-0.012	10.1%	5.08%
26	外购定制件	滚珠丝杆_HIWIN	SKDR030095-R20-20K2-FSC-440-550-0.012	8.5%	3.58%
27	外购定制件	滚珠丝杆_HIWIN	SKDR030390-4R25-25S2-DFSH-1170-1300-0.05	20.4%	14.91%
28	机械元件	滑块_HIWIN	HGH20CA	37.8%	31.54%
29	机械元件	导轨_HIWIN	HGR20R4000C	34.4%	28.32%
30	机械元件	导轨_HIWIN	MGN12C1R60Z0C E1=E2=5/75 分贝以下	23.6%	17.96%
31	机械元件	滑块_HIWIN	MGN9CZ0C	15.9%	10.59%
32	机械元件	导轨_HIWIN	MGN9R2000C	18.3%	12.92%

序号	采购类别	品名	规格	公司采购单价变动	市场价格变动
33	机械元件	滑块_HIWIN	HGL15CA	38.0%	31.69%
34	机械元件	导轨_HIWIN	MGN15C1R110Z0C E1=15 E2=15	26.5%	20.74%
35	机械元件	导轨_HIWIN	HGR15R4000C	41.5%	35.07%
36	机械元件	滑块_HIWIN	HGH20CA	29.1%	23.23%
37	机械元件	导轨_HIWIN	HGR20R4000C	25.4%	19.69%
38	机加钣金件	铝(国产)	/	32.8%	27.01%
39	机加钣金件	铝(进口)	/	18.7%	13.53%
40	机加钣金件	钢板	/	376.9%	356.12%
41	机加钣金件	铜	/	84.8%	76.76%
42	机加钣金件	JLD0100-752103A0 升降板- 喷砂氧化	6061 1.674/0.111	215.7%	201.97%
43	机加钣金件	JLD0100-752104A0 加强筋 2- 喷砂氧化	6061 0.601/0.055	212.8%	199.21%
44	机加钣金件	JLD0100-521101A0 侧板-喷 砂氧化	6061 1.262/0.087	217.0%	203.26%
45	机加钣金件	JLD0100-521102A0 侧板 2-喷 砂氧化	6061 2.524/0.174	217.8%	203.94%
46	机加钣金件	JLD0100-521301A0 支撑板- 喷砂氧化	6061 1.668/0.132	194.2%	181.45%

注：上表市场价格变动来自公司供应商数据；因公司原材料采购种类繁多，仅以上表为例说明采购价与市场价的变动对比。

由上表可知，公司原材料平均采购单价的波动与市场价波动趋势一致。

公司原材料采购种类繁多，且由于非标准化产品的要求存在差异，不同原材料零部件的形状、规格、大小、工艺等存在较大差别。公司建立了较为严格和完善的供应商筛选制度，多渠道、多途径筛选合格供应商，并对合格供应商名单进行动态化管理。从原材料品质、价格、交货期和服务以及供应商资质、规模、品牌等多个方面对于供应商进行评审和考核，建立合格供应商名录，确保原材料的质量和供应的稳定。同时，在采购价格方面，公司对主要原材料通常按照“同一材料，多家询价”的方式在采购时进行询价，实时了解原材料的价格行情，采购价格具有公允性，与市场价格一致。

综上，公司原材料平均采购价格上涨，与市场价格的变动趋势一致。

（二）毛利率下降趋势是否持续，是否对公司经营构成重大不利影响

公司 2021 年度综合毛利率为 33.06%，较上年的 38.65% 下降了 5.59 个百分点。公司预计未来毛利率下降趋势不会持续，毛利率将趋于稳定，主要原因包括：

1、虽然 2022 年初至今在上游大宗市场的带动下，主要原材料价格依然存在较大传导压力和上涨预期，但主要系受新冠疫情、地缘政治冲突等因素的影响。

随着未来全球疫情对各国复工复产的影响日益降低，上游大宗商品、原材料因短期供求关系带来的巨幅波动终将恢复正常、回归理性，长期来看，公司原材料采购价格预计将恢复正常水平；

2、深科达半导体与其核心零部件供应商达成了长期合作，预计零部件采购价格较为稳定，同时由于半导体设备产品逐渐打开市场，获得了客户的认可，产品销售均价也较为稳定，因此公司半导体设备产品的毛利率较为稳定，随着半导体设备收入金额和占比的上升，对公司整体毛利率具有较强的稳定作用；

3、未来随着公司募投项目的陆续投产，公司将进一步提高技术水平和持续盈利能力，且对部分毛利率低的订单具有更灵活的选择权，对公司整体毛利率具有提升作用，详见下述。

综上，公司预计未来毛利率下降趋势不会持续，毛利率将趋于稳定，对公司经营不存在重大不利影响。

（三）本次募投项目建成后对公司毛利率的影响

报告期内，公司主营业务分产品类别的毛利率情况如下：

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
平板显示模组设备	28.82%	-10.93%	39.75%	3.15%	36.60%	-1.15%	37.76%
半导体设备	32.88%	3.14%	29.74%	1.26%	28.48%	-5.61%	34.09%
直线电机	45.74%	-1.62%	47.36%	5.70%	41.66%	0.36%	41.31%
摄像模组类设备	28.49%	-11.76%	40.25%	-23.98%	64.23%	-	-
其他	36.87%	-2.60%	39.47%	11.40%	28.07%	2.51%	25.56%
主营业务毛利率	31.48%	-6.94%	38.42%	0.65%	37.77%	0.29%	37.48%
综合毛利率	31.71%	-6.94%	38.65%	0.76%	37.89%	0.29%	37.60%

报告期内，公司主营业务毛利率分别 37.48%、37.77%、38.42%和 31.48%，由于产品结构变化、原材料采购成本上涨、市场竞争加剧以及 OEM 采购占比上升等因素的影响，导致公司平板显示设备毛利率下降，对公司盈利水平构成一定的不利影响。

未来随着公司募投项目的陆续投产，公司将进一步提高技术水平和持续盈利能力。本次募投项目具体主要包括惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目和平板显示器件自动化专业设备生产建设项目。

根据公司初步测算，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目建成后，毛利率测算情况如下：

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10
毛利率	33.54%	34.85%	35.27%	35.27%	35.27%	35.27%	35.27%	35.27%	35.27%	35.27%

半导体先进封装测试设备研发及生产项目建成后，毛利率测算情况如下：

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10
毛利率	31.51%	33.06%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%

平板显示器件自动化专业设备生产建设项目建成后，毛利率测算情况如下：

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10
毛利率	37.04%	37.47%	37.76%	38.25%	38.20%	38.20%	38.15%	38.15%	38.09%	38.09%

关于惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目和半导体先进封装测试设备研发及生产项目投产后毛利率预测的合理性分析，详见审核问询函的回复之“2.关于收益测算”。

公司2020年和2021年1-9月的综合毛利率分别为38.65%和31.71%，由以上表格测算，公司以上三个募投项目建成投产后第一年的毛利率(T+1)分别为33.54%、31.51%、37.04%，虽然与公司2020年的综合毛利率38.65%相比偏低，但考虑到1)惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目和平板显示器件自动化专业设备生产建设项目的毛利率均高于公司2021年1-9月的综合毛利率31.71%；2)半导体先进封装测试设备研发及生产项目投产后第一年(T+1)的毛利率与公司2021年1-9月的综合毛利率持平，且预计随着募投项目的成熟运行，募投项目的毛利率将比投产第一年有所提升并逐渐稳定，因此本次募投项目建成后对公司产品毛利率具有提升和稳定作用。

首发募投项目和本次募投项目建成后，将对公司生产经营产生意义深远的影响，主要包括：

1、募投项目建成后，将有效地解决公司现有场地条件不能满足日益扩大的生产经营需求的问题，实现业务的持续增长，提升规模化效应，不断巩固并扩大公司在平板显示器件生产设备、半导体先进封装测试设备制造领域的优势；

2、通过建设生产车间，新增CNC数控机床、铣床、磨床等先进加工设备，增强公司钣金件、机加工件等自主生产能力，降低生产成本，保证产品质量及交期，进而提高对客户需求的快速响应能力，提升客户满意度；

3、本次募投项目的投资建设系公司在现有产品种类基础中，不断优化产品结

构,延伸产品线,可为客户提供更加丰富的产品选择方案,开辟新的利润增长点,是公司提高整体盈利能力,保障可持续发展的重要举措;

4、未来,在募投项目建成后具体的日常运营和成本管控中,1)公司对部分低毛利率的订单将具有更灵活的选择权,把人力、资本等资源集中在具有更好效益的订单上。2)公司将最大化的发挥拟建厂房和购置设备的使用效益,统筹研发设计、机加钣金、装配调试等具体研制生产工序,避免长期闲置。3)公司将持续贯彻“精细化管理”和“以销定产”的生产模式,将新增产能有计划、有步骤地释放,同时将现有的一部分生产人力资源逐步分批转移至募投项目上。

综上,本次募投项目和首发募投项目建成后,产能的逐步释放将足以覆盖募投项目新增折旧、人工成本的增加等,稳定和提升整体毛利率水平,对公司生产经营产生积极正面的影响,增强盈利能力。

公司已在募集说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”之“(三)发行人的其他风险”之“1、原材料价格波动对发行人业绩影响较大的风险”以及“第三节 风险因素”之“三、财务风险”之“(一)原材料价格波动对发行人业绩影响较大的风险”对原材料价格波动影响公司业绩进行了风险提示。

五、2021年营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配的原因及合理性,公司生产经营是否出现重大不利变化

(一)2021年营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配的原因及合理性(本回复中2021年度数据未经审计)

根据业绩快报,公司2021年度营业收入增长26,322.31万元,增长率为40.62%,其中,公司保持与国内主要面板生产企业的长期合作,平板显示设备业务实现营业收入51,598.07万元,较去年同期增长18.33%;半导体设备在市场上取得了客户的广泛认可,在2021年度实现营业收入27,736.89万元,较去年同期增长130.15%;直线电机业务持续围绕下游电子电工设备、机械自动化设备市场需求进行拓展,2021年度实现营业收入6,434.94万元,较去年同期增长39.88%。

2021年度,公司归属于母公司所有者的净利润下滑21.21%,营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配,主要由成本增长率高于收入增长率导致毛利率下降、销售费用增长率高于收入增长率等原因导致。

1、成本增长率高于收入增长率导致毛利率下降

公司2021年度营业收入较去年增长26,322.31万元,增长率为40.62%,营业

成本较上年增长 21,242.11 万元，增长率为 53.43%，成本增长率高于营业收入的增长率，导致产品毛利率下降。

2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司主营业务分产品类别的毛利率情况如下：

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动
平板显示模组设备	31.26%	-8.49%	39.75%	3.15%	36.60%	-1.15%
半导体设备	32.67%	2.93%	29.74%	1.26%	28.48%	-5.61%
直线电机	44.63%	-2.73%	47.36%	5.70%	41.66%	0.36%
摄像模组类设备	36.25%	-4.00%	40.25%	-23.98%	64.23%	-
其他	38.18%	-1.29%	39.47%	11.40%	28.07%	2.51%
主营业务毛利率	32.99%	-5.43%	38.42%	0.65%	37.77%	0.29%
综合毛利率	33.06%	-5.59%	38.65%	0.76%	37.89%	0.29%

注：上表 2021 年度的数据未经审计。

2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司主营业务毛利率分别为 37.77%、38.42% 和 32.99%，其中 2021 年度下降 5.43 个百分点。公司各类产品之间的毛利率存在差异，综合毛利率下降主要是受平板显示模组业务及其他具有综合影响的因素（如原材料价格变动、市场竞争等）影响。

（1）原材料采购价格上涨

受新冠疫情、海运不畅、贸易保护等因素的影响，2021 年公司主要原材料在上游大宗商品、芯片等的带动下，价格整体上涨。其中铜、铁、铝等大宗商品价格普遍出现明显上涨，芯片因供求关系、贸易保护等因素的影响价格大幅上涨，并逐步传导到下游电气元件、机械元件、机加钣金件等行业，导致电气元件、机械元件、机加钣金件等原材料价格上涨。

原材料采购具体情况详见本题之“四、原材料市场价及采购价的变动情况是否一致，毛利率下降趋势是否持续，是否对公司经营构成重大不利影响，本次募投项目建成后对公司毛利率的影响”。

（2）平板显示模组设备中采用 OEM 方式生产的占比提高

公司平板显示模组设备的部分辅助设备产品主要用于满足客户的配套需求，销售额受个别客户的需求变动呈现大幅波动，公司综合考虑订单数量、交期要求、生产计划、自制与外购的效益对比等因素，对部分平板显示模组设备进行定制化 OEM 采购。公司研发工程师确定好图纸规格或方案后，与供应商签订设备规格书，

供应商按照设备规格书的要求进行生产加工。规格书一般会对以下内容进行约定，主要包括：设备布局、工艺要求、核心单元设计要求、主要配件规格等。

2019年度、2020年度和2021年度，公司采用OEM方式生产的平板显示模组设备与自制设备的收入占比及毛利率情况如下：

公司名称	2021年度		2020年度		2019年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
自制设备	70.84%	36.71%	90.22%	41.45%	83.74%	40.48%
OEM方式生产设备	29.16%	18.03%	9.78%	24.12%	16.26%	16.62%
平板显示模组设备	100.00%	31.26%	100.00%	39.75%	100.00%	36.60%

注：上表2021年度的数据未经审计。

2019年度、2020年度和2021年度，平板显示模组设备业务收入中采用OEM方式生产设备的销售占比分别为16.26%、9.78%和29.16%，公司2021年人力、资本等资源主要聚焦在核心产品的研制或布局，对于辅助性的设备，公司综合考虑订单数量、自制与外购的效益对比等因素，对部分设备进行OEM采购，因此导致2021年度的占比大幅提升。由于OEM厂商需留存部分利润，因此采用OEM方式生产的平板显示模组设备的销售毛利率远低于公司自制的设备毛利率，降低了公司的综合毛利率水平。

(3) 平板显示模组设备的产品结构变化

公司生产的贴合类设备属于下游生产必需设备，销售议价能力较强，毛利率相对较高，而其他的平板显示模组设备产品主要完成辅助功能，销售议价能力相对较弱，毛利率相对较低，公司2021年度平板显示模组设备中非贴合类设备产品销售较多，在一定程度上拉低了毛利率。

平板显示模组设备由贴合设备、邦定设备、检测设备、辅助设备及其他构成，各细分产品的毛利率及其收入占比情况如下：

项目	2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
贴合设备	40.22%	48.59%	45.28%	51.87%	41.35%	44.95%
邦定设备	19.74%	2.13%	19.27%	1.49%	13.60%	2.12%
检测设备	31.01%	11.02%	42.47%	16.55%	30.03%	25.80%
辅助设备及其他	20.61%	38.25%	29.75%	30.09%	36.78%	27.14%
平板显示模组设备	31.26%	100.00%	39.75%	100.00%	36.60%	100.00%

注：上表2021年度的数据未经审计。

公司平板显示模组设备2021年度的毛利率较上年下降8.49个百分点，在产

品结构方面的原因包括：（1）毛利率相对较高的贴合设备的收入占比从 51.87% 下降到 48.59%，且其毛利率也从 45.28% 下降到 40.22%；（2）辅助设备及其其他的收入占比从 30.09% 增长到 38.25%，且其毛利率从 29.75% 下降到 20.61%。

（4）国内平板显示器件生产设备行业市场竞争进一步增加

随着平板显示行业的发展以及生产设备国产化的稳步推进，国内平板显示领域投资增多，相关生产设备领域吸引了众多参与者，尤其在后段组装和检测设备领域。此外，当下游面板或模组生产企业考虑到终端产品将进入弱周期时，设备厂商作为上游供应商会更早受到影响，所面临的市场竞争通常会进一步增加，毛利率空间被压缩。

（5）同行业可比公司经营情况对比分析

根据公开披露的信息，公司与可比上市公司 2021 年度营业收入及归属于母公司所有者的净利润情况如下：

公司名称	营业收入及利润情况
联得装备	根据三季度报告，收入同步增长 20.02%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 58.44%；根据业绩预告，2021 年度盈利 2,000 万元-2,500 万元，2020 年度盈利 7,429.04 万元，比上年同期下降 73.08%-66.35%
易天股份	根据三季度报告，收入同步增长 10.39%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 18.73%
智云股份	根据业绩预告，归属于母公司所有者的净利润 2021 年度亏损 55,000 万元-80,000 万元，2020 年度盈利 3,623.74 万元
正业科技	根据业绩预告，扣除非经常性损益后的净利润约盈利 1,000 万元-1,450 万元
深科达	根据业绩快报，2021 年度收入增长 40.62%，归属于母公司所有者的净利润下滑 21.21%

由上表可知，联得装备、智云股份的利润下滑幅度较大；正业科技实现扭亏为盈，主要是工业检测设备产品的市场行情向好，尤其是锂电检测自动化板块市场需求大增，全年接单金额超过 6 亿元，2021 年锂电检测自动化业务全年接单金额较 2020 年全年接单金额同比增长超过 30%。

2021 年 1-9 月，公司综合毛利率与可比公司对比情况如下：

公司名称	2021 年 1-9 月		2020 年度
	综合毛利率	较上年变动	综合毛利率
联得装备	26.66%	-2.23%	28.89%
易天股份	47.96%	6.85%	41.11%
智云股份	29.56%	-1.44%	31.00%
正业科技	35.41%	9.55%	25.86%
平均值	34.90%	3.18%	31.72%
深科达	31.71%	-6.94%	38.65%

注：为增加 2020 年度数据的可比性，智云股份的数据取自平板显示模组设备、正业科技的数据取自平板显示模组自动化设备；2021 年 1-9 月因季报披露信息较为简单，仅采用全部收入、成本数据计算。

基于上述数据统计口径，2021 年 1-9 月各可比公司中，公司、联得装备、智云股份的毛利率较上年度下降，易天股份、正业科技的综合毛利率呈上升态势。根据公开资料，2021 年 1-9 月，易天股份部分订单毛利率较高；正业科技锂电检测自动化设备的收入大幅增长，且该类别产品收入的毛利率较高。公司综合毛利率处于可比公司中值水平。

2021 年度，公司综合毛利率为 33.06%（数据未经审计），较 2021 年 1-9 月的综合毛利率有所上升。

综上，公司 2021 年度营业收入增长势头良好，平板显示模组设备、半导体设备、直线电机的收入均增长较快。原材料价格上涨、平板显示模组设备中 OEM 方式生产的设备占比与非贴合类设备占比上升、市场竞争等因素导致公司营业成本增长率较高、毛利率下降，是公司归属于母公司所有者的净利润较上年下降 21.21% 的主要因素。

2、销售费用增长率高于收入增长率

根据公司业绩快报，2021 年度，公司销售费用较去年增长 4,387.49 万元，增长率为 63.52%，与营业收入的变动趋势一致，但变动幅度不同，销售费用的增长率高于营业收入的增长率。

2021 年度，公司销售费用各明细项目的变动如下：

单位：万元

项目	2021 年度			2020 年度	
	金额	占比	较上年度变动	金额	占比
职工薪酬	5,969.38	52.85%	58.58%	3,764.25	54.50%
差旅费	2,275.98	20.15%	46.37%	1,555.00	22.51%
物料消耗	847.43	7.50%	18.30%	716.36	10.37%
招待费	541.37	4.79%	34.81%	401.57	5.81%
咨询费	79.90	0.71%	117.59%	36.72	0.53%
投标费	43.02	0.38%	-18.78%	52.97	0.77%
租赁管理费	88.64	0.78%	21.09%	73.20	1.06%
业务宣传费	107.30	0.95%	1219.80%	8.13	0.12%
劳务外包费	1,027.54	9.10%	551.83%	157.64	2.28%
其他	313.90	2.78%	122.42%	141.13	2.04%
合计	11,294.46	100.00%	63.52%	6,906.97	100.00%

注：上表 2021 年度的数据未经审计。

由上表可知销售费用的增长主要由职工薪酬、劳务外包费带动。

随着公司业务规模扩大，公司销售人员人数大幅增长，销售人员人数由 2020 年度的 278 人提高到 2021 年度的 367 人（按当期各月销售人员人数加总/月份数计算取整得出），人数增长 32.01%，建立起比较完善的销售人才体系。

随着公司首发募投项目和本次募投项目的建成投产，公司现有销售团队将发挥市场开拓的主体作用，考虑到新产品、新技术的应用需要进行必要的市场推广，公司预计将在募投项目建成投产后补充必要的销售人员人数。公司将统筹考虑人力成本与收益，制定行之有效的激励体系，确保销售人员增加带来效益增长的同时，不断提升投入产出比。

销售费用中的劳务外包主要为满足售后服务的需要，费用支出受产品交付地点和疫情的影响。2021 年度收入规模增长需要较多的售后维护服务，且之前年度已经完成的部分销售也需要持续的售后服务，劳务外包支出增长较快，具体主要如下：

1、2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司主营业务收入的外销收入金额分别为 56.43 万元、3,126.92 万元和 3,642.94 万元。外销收入主要来自台湾地区，因为疫情原因，公司员工无法抵达台湾当地对客户进行售后服务，因此在当地聘请符合条件的公司协助进行售后服务，其中 2021 年度因对友达光电、群创光电等客户进行售后服务发生支出合计 411.40 万元。

2、报告期各期，国内销售业务也大幅增长。受疫情影响，公司员工在进行疫情管控的期间难以在当地及时开展工作，同时业务规模的增长使得售后服务的工作量亦有所加大，因此公司在境内因聘请符合条件的公司协助进行售后服务，而产生的支出亦有所增加。

2021 年度，公司聘请的提供售后服务劳务外包的主要供应商及其服务的客户如下：

序号	劳务外包供应商	金额 (万元)	服务的客户
1	逸丰科技股份有限公司	203.33	群创光电、业泓科技、台湾凌巨
2	深圳汇创自动化科技有限公司	200.49	德普特、安徽国显、芜湖长信、武汉华星光电、成都业泓、捷普绿点
3	深圳市鸿顺智能装备有限公司	145.05	广州维信诺、绵阳京东方、成都京东方
4	深圳市泓辉人力资源有限公司	141.90	武汉华星光电、合肥京东方、武汉天马、广州维信诺、成都业成
5	科宣实业有限公司	129.79	群创光电、友达
	合计	820.56	/

报告期各期，公司销售费用占营业收入的比例与同行业可比上市公司的情况

如下：

公司名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
联得装备	6.14%	5.33%	5.46%	6.35%
易天股份	13.05%	12.23%	10.66%	10.29%
智云股份	16.64%	6.13%	22.12%	7.89%
正业科技	8.37%	9.49%	12.98%	9.13%
可比公司平均值	11.05%	8.30%	12.81%	8.42%
深科达	11.91%	10.66%	11.68%	11.85%

由上表可以看出，公司销售费用占营业收入的比例与可比公司平均值差异较小，与各可比公司相比，公司销售费用占营业收入的比例处于中等水平。一方面，在2018年度、2019年度，公司业务规模与联得装备、正业科技等相比较小，销售费用占比的敏感性较高。另一方面，报告期内公司业务持续增长，围绕智能装备行业进行布局与延伸，且半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，销售费用占比略有提升。报告期内，公司销售费用占收入的比例分别为11.85%、11.68%、10.66%和11.91%，整体而言比较稳定。同行业可比公司中，销售费用占营业收入的比例易天股份呈逐期增长的趋势，智云股份具有较大的波动性，联得装备整体上占比较低。

最近两年一期，公司营业收入较上年增长率与同行业可比公司情况如下：

公司名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度
联得装备	-12.07%	13.59%	3.77%
易天股份	-27.57%	-12.00%	13.31%
智云股份	-60.00%	291.67%	-68.94%
正业科技	-5.13%	14.47%	-26.80%
可比公司平均值	-26.19%	76.93%	-19.66%
深科达	9.72%	37.31%	3.65%

由上表可知，公司在销售费用方面的投入获得了合理的回报，营业收入持续增长，2020年度、2021年1-9月分别较上年增长37.31%和9.72%，根据业绩快报2021年度的收入增长率高达40.62%。

综上，报告期内，公司销售费用占收入的比例分别为11.85%、11.68%、10.66%和11.91%，整体上比较稳定。公司销售费用的增长率高于营业收入具有合理性。

（二）公司生产经营是否出现重大不利变化

报告期内，公司主营业务、经营模式、生产模式，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

公司主要产品包括平板显示模组设备、半导体设备、直线电机、摄像模组类

设备等。

一方面，公司近年来围绕智能装备行业持续进行布局与延伸，根据2021年度业绩快报，营业收入较2020年增长26,322.31万元，增长率为40.62%，势头良好，平板显示模组设备、半导体设备、直线电机的收入均增长较快。另一方面，由于原材料采购价格上涨、OEM方式生产的设备销售占比上升、平板显示模组设备产品结构变化以及市场竞争加剧等因素影响，导致公司2021年度营业成本较上年增长21,242.11万元（未经审计），增长率为53.43%，产品毛利率下降，加之销售费用的增长幅度较大，对公司盈利水平构成一定的不利影响。

对盈利水平的不利影响因素中，结合上述毛利率分析具体看来：

1、原材料价格因新冠疫情、国际贸易形势等突发情况导致出现大幅波动，2022年以来新冠疫情反复、地缘政治冲突加重了这一形势，但从长期来看，原材料价格会逐渐回归正常水平，供需关系将回归理性；

2、对于OEM方式协助生产属于内部经营决策方面的因素，具有较大的决策自主灵活性，公司在满足正常经营需求和产能的前提下，可以适时调整采用OEM方式生产的具体安排，以调动、聚焦更多的资源满足重点布局产品的研发、生产和销售。长期来看，有利于扩大经营规模、提升市场份额、提高整体盈利水平；

3、根据过往多年经验，平板显示模组产品结构的变化将持续，随着面板显示技术的不断迭代、面板企业投资意愿的周期波动，公司平板显示模组产品面临的细分产品需求亦将同步变动，公司将密切跟踪产业发展态势与客户需求，把握未来市场机遇，稳定并提升平板显示模组产品长期的毛利率水平；

4、市场竞争加剧，虽然带来毛利率的周期波动，但整体上竞争处于有序状态，且随着下游市场容量的扩大及新产品、新技术的应用，相关产品在长期的市场竞争中将持续迭代、健康发展；

5、虽然公司2021年度销售费用增长率高于营业收入增长率，但是销售费用增长金额不大，销售费用占营业收入的比例略有上升，报告期内占比总体较为稳定，公司在销售费用方面的投入获得了合理的回报，营业收入持续增长。因此，公司生产经营不存在重大不利变化。

此外，对于2021年度而言，在上游原材料价格上涨、新冠疫情以及国际贸易冲突升级和经济形势严峻的宏观环境下，同行业可比公司的整体盈利水平亦不乐观，基于自身技术优势，向上下游或周边产业渗透发展是目前整体的发展趋势。

综上，公司2021年营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配具有合理性，符合公司生产经营实际，公司生产经营不存在重大不利变化，与同

行业可比公司相比，公司盈利水平良好。

六、申报会计师的核查程序和核查意见

（一）核查程序

申报会计师履行了以下主要核查程序：

1、获取发行人的应收账款、营业收入明细表，分析应收账款占营业收入比重大幅增长的原因及合理性；

2、获取发行人的应收账款逾期统计表，分析其与发行人信用政策的匹配性；

3、检查应收账款、逾期应收账款的期后回款情况，分析其是否存在重大坏账风险；

4、查阅同行业可比公司公开披露的信息，对比分析同行业可比公司应收账款占营业收入比重的变动、应收账款坏账准备计提比例对比、应收账款周转率等情况；

5、核查2021年三季度末无订单商品的试用及期后销售情况；

6、复核存货跌价准备计提情况，核实跌价准备是否计提充分；

7、查阅同行业可比公司公开披露的信息，对比分析同行业可比公司存货跌价准备计提比例、存货周转率、存货余额占总资产的比例等情况；

8、核查发行人最近一期销售人员增长和劳务外包情况，对管理层进行访谈并了解销售人员人数及劳务外包支出大幅增长的原因，分析其合理性；

9、查阅网络公开信息，了解上游大宗商品、芯片及电气元件、机械元件等原材料的市场价格波动情况；

10、获取采购明细表，了解并分析发行人原材料采购价格的变动情况；

11、对管理层进行访谈，了解毛利率下降的原因及对经营管理产生的影响；

12、获取募投项目毛利率测算表，分析募投项目投产后对产品毛利率的影响；

13、查阅同行业可比公司公开披露的信息，对比分析同行业可比公司2021年度的营业收入和利润变化情况。

（二）核查结论

经核查，申报会计师认为：

1、发行人信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长的原因具有合理性，发行人不存在重大坏账风险；

2、发行人2021年三季度末无订单商品的试用及销售情况符合生产经营实际，存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值的原因具有合理性，存货跌价准备计提充分；

3、发行人销售人员人数及劳务外包支出同时大幅增长的原因具有合理性；

4、原材料市场价与发行人原材料采购价的变动趋势一致，发行人毛利率下降趋势预计不持续，对发行人经营不构成重大不利影响，本次募投项目建成后对发行人毛利率具有提升和稳定作用；

5、发行人2021年营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配的原因具有合理性，发行人生产经营不存在重大不利变化。

专此说明，请予察核。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

杨谦

中国注册会计师：

李民聪

二〇二二年四月十四日